股票代碼: 8110

華東科技股份有限公司

113 年報

公開資訊觀測站網址： https://mops.twse.com.tw
本公司年報網址： https://www.walton.com.tw

中華民國一一四年五月二十日刊印

一、本公司發言人：

姓名： 黃靖窈　　職稱： 財務長暨財會處協理

電話： (07)811-1330　　E-mail： leen @walton.com.tw

代理發言人：

姓名： 蘇琨發　　職稱： 行政處處長

電話： (07)811-1330　　E-mail： kensu@walton.com.tw

二、總公司及工廠地址、電話：

公司：高雄市前鎮區北一路十八號

電話：(07)811-1330

工廠：高雄市前鎮區北一路十七號、北一路十八號、北一路二十八號

電話：(07)811-1330

三、辦理股票過戶機構

名稱：華東科技股份有限公司股務辦事處

地址：台北市內湖區行善路 398 號 8 樓

電話：02-2790-5885

網址：http://stock.walsin.com

四、最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師名稱：許瑞軒會計師、劉裕祥會計師

地址：高雄市前鎮區成功二路 88 號 3 樓

電話：(07)530-1888

網址：www.deloitte.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱公司及查詢海外有價證券資訊之方式：不適用。

六、公司網址：https://www.walton.com.tw

目　　錄

壹、致股東報告書 1

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 3

二、公司治理運作情形 14

三、會計師公費資訊 46

四、更換會計師資訊 46

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或關係企業之期間 47

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 47

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 48

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 50

參、募資情形

一、資本及股份 51

二、公司債辦理情形 53

三、特別股辦理情形 53

四、海外存託憑證辦理情形 53

五、員工認股權憑證辦理情形 53

六、限制員工權利新股辦理情形 53

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 53

八、資金運用計畫執行情形 53

肆、營運概況

一、業務內容 54

二、市場及產銷概況 65

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率 80

四、環保支出資訊 80

五、勞資關係 80

六、資通安全管理 83

七、重要契約 86

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 87
二、財務績效 88
三、現金流量 88
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 89
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 89
六、風險事項 89
七、其他重要事項 90

陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料 91
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 91
三、其他必要補充說明事項 91

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所訂，對股東權益或證券價格有重大影響之事項 91

壹、致股東報告書

2024 年全球經濟呈現溫和復甦的態勢，全球通膨壓力緩解，但仍受地緣政治、通膨與貨幣政策影響。美國經濟穩健成長，歐洲需求疲軟，中國則透過政策刺激維持增長。受惠於全球需求的復甦、人工智慧（AI）技術的蓬勃發展以及供應鏈庫存調整的結束，市場正從 2023 年的低谷逐步回升。

以全球區域半導體市場來看，美國、中國大陸與亞太三大區域市場為領先族群。其中，美國市場銷售額達 1,946 億美元，年增 44.8%，展現強勁成長動能。中國大陸市場銷售額為 1,825 億美元，較 2023 年成長 18.3%。亞太地區（不含中國）市場銷售額達 1,527 億美元，年增 12.5%。整體而言，2024 年全球半導體市場呈現穩健成長態勢，整體銷售值、總銷貨量及平均銷售單價（ASP）均較 2023 年有所提升。全年總銷售值達 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%，顯示市場需求回溫。總銷售量方面，2024 年全球半導體出貨量達 9,525 億顆，較 2023 年成長 3.42%，顯示市場需求穩定復甦，整體出貨量呈現正向成長。2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元，較 2023 年增長 22.4%，顯示台灣半導體產業強勁的復甦動能，遠高於全球半導體產業平均增速，鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。

華東科技在 2024 年整體成績較 2023 年為佳，在營收及獲利上都較 2023 年成長，2024 年全年合併營收為新台幣 78.59 億元，營業毛利為新台幣 4.98 億元，營業淨利計新台幣 0.79 億元，稅後純益歸屬於本公司業主計新台幣 1.34 億元，每股稅後盈餘為 0.26 元。

2024 年庫存去化接近尾聲，半導體市場呈現全面復甦，需求逐步回升， AI 晶片為產業增長的主要驅動力。2024 年半導體平均銷售單價（ASP）達 0.659 美元，較 2023 年成長 14.32%，顯示出高價值產品占比提升，這反映了市場對高階半導體產品的需求增加，並帶動整體產業價值的提升。隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子及物聯網（IoT）等應用持續推動市場需求，半導體產業仍將維持成長態勢，特別是 AI 技術的快速發展，帶動先進製程晶片、高頻寬記憶體（HBM）及特殊應用晶片（ASIC）的需求增加，進一步推升整體市場規模。此外，消費性電子復甦、5G 與 Wi-Fi 7 的普及，以及各國對半導體供應鏈自主化的推動，也將持續影響市場格局。WSTS 預估 2025 年全球半導體產業將成長 11.2%，產值達 6,979 億美元。半導體產業正從 2021-2024 年的波動調整期邁向更加多元、韌性和創新驅動的新階段，而 2025 年無疑是這一轉型過程中關鍵的一年。整體而言，中短期內，智慧型手機、平板電腦

與伺服器三大應用仍為 DRAM 市場需求的主要支柱。而從中長期來看，生成式 AI 應用的崛起推動 AI 伺服器需求大幅增長，加上穿戴式裝置、智慧汽車、智慧家庭以及萬物互聯（IoT）技術的普及，均將進一步帶動全球記憶體市場的發展。綜觀市場趨勢，記憶體產業可望在多元應用驅動下，維持穩定且持續的成長動能。

然而，2024 年國際貿易格局持續受到地緣政治因素影響，貿易保護主義加劇，中美關係持續緊張的態勢以及地緣政治關係依然是全球產業生態的主軸。美中兩國在多次會談與協商後，仍持續採取提高關稅、貿易制裁及限制前瞻技術獲取等措施，使雙方在科技領域的競爭愈發激烈，至今未見緩解跡象。此外，俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治衝突頻發，進一步加深了全球經濟與產業供應鏈的不確定性。地緣政治因素及供應鏈安全考量也將為台灣 IC 產業帶來新的機遇與挑戰，台灣擁有全球最完整的產業供應鏈，在技術創新、產能擴充及國際合作等方面之持續投入，是台灣 IC 產業保持全球競爭力的關鍵，因此台灣在全球半導體產業中仍具有舉足輕重之地位。

面對快速變遷的產業環境，華東科技將秉持技術創新精神，以客戶信任為基礎，專注於品質、成本、交期與服務的持續提升，以及透過最佳化的營運管理，提供高效能的客戶服務，強化客戶關係，亦憑藉技術創新與垂直整合優勢，深化與客戶的戰略夥伴關係，積極研發更高效、更輕薄且具成本效益的記憶體封測解決方案，以滿足市場對新一代記憶體產品的需求，亦積極響應全球減碳趨勢，將 ESG 永續發展原則納入營運規劃，推動低碳轉型，確保企業在全球市場中的競爭力與長期發展。同時藉由優異的營運效率確保持續投資的能力，致力於穩健經營，以達成永續成長的目標。

董事長　焦佑衡

貳、公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一) 董事資料：

1.董事資料：

114 年 4 月 13 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註(註1)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	焦佑衡	男 61-70	111.6.14	三年	84.3.16	9,208,592	1.77	10,208,592	1.97	463,071	0.09	0	0	美國舊金山金門大學碩士 華新麗華(股)公司副董事長	華東科技(股)公司董事長兼執行長 華新科技(股)公司、信昌電子陶瓷(股)公司、瀚宇博德(股)公司、台灣精星科技(股)公司、精成科技(股)公司、閎暉實業(股)公司董事長；華新麗華(股)公司、Walton Holding Universal Ltd.、Walton Holding (Hong Kong) Ltd.、Silitech (BVI) Holding Ltd.、精博信華實業(香港)有限公司、華新電子(新加坡)有限公司董事	董事	焦佑倫	二親等	無
董事	中華民國	華新麗華(股)公司 代表人：焦佑倫	男 61-70	111.6.14	三年	84.3.16	109,628,376 4,874,448	21.01 0.93	109,628,376 4,874,448	21.17 0.94	0 1,218,611	0 0.24	0 0	0 0	華盛頓大學企管碩士 華新麗華(股)公司總經理 中國鋼鐵(股)公司董事 台新銀行(股)公司董事	華新麗華(股)公司董事長兼執行長 華新能源電纜系統(股)公司、漢友創業投資(股)公司董事長 華新麗華(股)公司所屬之子公司董事/Vice President Commissioner	董事長	焦佑衡	二親等	無
董事	中華民國	華邦電子(股)公司 代表人：詹東義	男 61-70	111.6.14	三年	87.5.11	50,062,641 60,000	9.60 0.01	50,062,641 60,000	9.67 0.01	0 0	0 0	0 0	0 0	美國加州大學柏克萊分校電機工程博士 BCD Semiconductor CEO 華邦電子銷售中心副總經理 華邦北美子公司總經理 Siliconix 技術經理 Cypress 技術經理 Intel 高級工程師 華邦電子(股)公司總經理	華邦電子(股)公司副董事長兼副執行長；華邦集成電路(蘇州)有限公司、Winbond Electronics Corporation America 董事長；Winbond International Corporation、Winbond Electronics Corporation Japan、Winbond Technology Ltd、Marketplace Management Ltd.董事	無	無	無	無
董事	中華民國	華新科技(股)公司 代表人：東耀先	男 71-80	111.6.14	三年	111.6.14	31,870,087 0	6.11 0	31,870,087 0	6.16 0	0 0	0 0	0 0	0 0	北卡羅萊納大學企管所碩士 菁英綜合證券(股)公司總經理 瀚宇博德(股)公司總經理 泰金寶電子公司行政管理處處長全	嘉聯益科技(股)公司法人董事代表 財團法人華科慈善基金會董事	無	無	無	無
董事	中華民國	于鴻祺	男 61-70	111.6.14	三年	84.3.16	1,898,508	0.36	1,708,508	0.33	0	0	0	0	史丹佛大學碩士 普林斯頓大學學士 友利電子(股)公司總經理 華新科技(股)公司監察人	華東科技(股)公司總經理 華東科技(蘇州)有限公司董事長 華昕科技(蘇州)有限公司董事長 Walton Holding Universal Ltd.董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	呂禮正	男 61-70	111.6.14	三年	93.6.24	0	0	0	0	0	0	0	0	澳洲Bond大學電腦研究所 藍晶光電科技(股)公司總經理 仲捷建設(股)公司總經理 青雲國際科技(股)公司財務行政執行副總及總經理 承啟科技(股)公司董事長	青雲視訊(股)公司董事長 鈞傳(股)公司董事長 世宏智能科技(股)公司董事長 承啟科技(股)公司法人董事代表 安信電商(股)公司法人董事代表	無	無	無	無

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選(就)任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事			備註(註1)
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	郝海晏	男 61-70	111.6.14	三年	93.6.24	316,837	0.06	316,837	0.06	0	0	0	0	普度大學博士 台灣大學電機系副教授 資策會金融事業群副總經理 英特格瑞資訊(股)公司董事長 心盛醫學影像(股)公司董事長 嘉爾管理顧問董事長	嘉和國際投資(股)公司董事長 聯合骨科器材(股)公司董事	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	林旺財	男 71-80	111.6.14	三年	108.6.25	0	0	0	0	0	0	0	0	台北商業職業學校 銘懋工業(股)公司董事長 華新麗華(股)公司董事 華邦電子(股)公司監察人 華新科技(股)公司監察人	無	無	無	無	無
獨立董事	中華民國	邱靖雅	女 51-60	111.6.14	三年	111.6.14	0	0	0	0	0	0	0	0	輔仁大學 PURE GROUP CEO China CHANEL Managing Director NIKE Greater China General Manager 富美康健(股)公司總經理	和成欣業(股)公司獨立董事	無	無	無	無

註1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。

2.法人股東之主要股東：

114 年 4 月 13 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東
華新麗華(股)公司	金鑫投資股份有限公司 6.15%、華邦電子股份有限公司 6.14%、東元電機股份有限公司 5.22%、榮江股份有限公司 4.95%、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 4.54%、華俐投資股份有限公司 2.65%、焦佑慧 1.74%、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.67%、焦佑衡 1.62%、中華郵政股份有限公司 1.49%
華邦電子(股)公司	華新麗華股份有限公司 22.11%、金鑫投資股份有限公司 6.31%、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 1.72%、焦佑鈞 1.53%、新制勞工退休基金 1.44%、國泰人壽保險股份有限公司 1.37%、美商摩根大通銀行台北分行託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.00%、洪白雲 0.97%、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 0.96%、焦佑衡 0.58%
華新科技(股)公司	華新麗華股份有限公司 18.30%、瀚宇博德股份有限公司 8.71%、精成科技股份有限公司 4.36%、華東科技股份有限公司 2.75%、焦佑衡 2.65%、花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行金英證券私人有限公司投資專戶 2.33%、智嘉投資股份有限公司 1.37%、金鑫投資股份有限公司 1.28%、采邑股份有限公司 1.11%、華邦電子股份有限公司 1.09%

3.主要股東為法人者其主要股東：

114 年 4 月 13 日

法人名稱	法人之主要股東
華邦電子(股)公司	華新麗華股份有限公司 22.11%、金鑫投資股份有限公司 6.31%、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 1.72%、焦佑鈞 1.53%、新制勞工退休基金 1.44%、國泰人壽保險股份有限公司 1.37%、美商摩根大通銀行台北分行託管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 1.00%、洪白雲 0.97%、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 0.96%、焦佑衡 0.58%
金鑫投資(股)公司	華邦電子股份有限公司 37.69%、華新麗華股份有限公司 36.99%、華俐投資股份有限公司 4.43%、焦佑鈞 3.14%、焦佑倫 3.14%、焦佑衡 3.14%、焦佑麒 3.14%、華新科技股份有限公司 1.86%、瀚宇博德股份有限公司 1.34%、信昌電子陶瓷股份有限公司 0.72%
東元電機(股)公司	寶佳資產管理股份有限公司 17.45%、華新麗華股份有限公司 10.81%、嘉源投資有限公司 5.29%、群益台灣精選高息 ETF 基金專戶 2.69%、合遠國際投資有限公司 2.36%、菱光科技股份有限公司 2.20%、東光投資股份有限公司 1.50%、光元實業股份有限公司 1.25%、英毅國際投資股份有限公司 1.05%、有萬國際投資股份有限公司 0.98%
華俐投資(股)公司	瀚宇彩晶股份有限公司 100%
榮江(股)公司	田江股份有限公司 58.19%、環華豐股份有限公司 41.81%
中華郵政(股)公司	交通部 100%
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司 100%

法人名稱	法人之主要股東
華新麗華(股)公司	金鑫投資股份有限公司 6.15%、華邦電子股份有限公司 6.14%、東元電機股份有限公司 5.22%、榮江股份有限公司 4.95%、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀行(新加坡)有限公司投資專戶 4.54%、華俐投資股份有限公司 2.65%、焦佑慧 1.74%、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶 1.67%、焦佑衡 1.62%、中華郵政股份有限公司 1.49%
瀚宇博德股份有限公司	華新科技股份有限公司 20.32%、華新麗華股份有限公司 12.06%、嘉聯益科技股份有限公司 5.44%、金鑫投資股份有限公司 3.55%、焦佑衡 2.19%、行行投資有限公司 2.15%、洪白雲 1.91%、信昌電子陶瓷股份有限公司 1.07%、采邑股份有限公司 0.96%、語岳股份有限公司 0.89%
精成科技股份有限公司	瀚宇博德股份有限公司 40.65%、台北富邦商業銀行股份有限公司受託保管復華台灣科技優息 ETF 證券投資信託基金專戶 3.48%、焦佑衡 1.18%、摩根大通託管 JP 摩根證券有限公司專戶 1.01%、安聯台灣大壩基金專戶 0.80%、廖敏惠 0.80%、統一黑馬基金專戶 0.72%、匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管 ENSIGNPEAK 顧問公司投資專戶 0.71%、匯豐託管三菱 UFJ 摩根士丹利證券交易戶 0.69%、匯豐銀行託管法國興業歐洲選擇權投資專戶 0.65%
華東科技股份有限公司	華新麗華股份有限公司 21.17%、華邦電子股份有限公司 9.67%、信昌電子陶瓷股份有限公司 6.16%、華新科技股份有限公司 6.16%、瀚宇博德股份有限公司 2.85%、焦佑衡 1.97%、焦佑倫 0.94%、渣打國際商業銀行營業部受託保管箭道投資信託之子基金箭道全球股票 ACWI 信託基金投資專戶 0.70%、李春份 0.49%、梁蘭云 0.43%
智嘉投資股份有限公司	技嘉科技股份有限公司 100%
采邑股份有限公司	華新麗華股份有限公司 33.97%、華新科技股份有限公司 26.62%、金鑫投資股份有限公司 8.23%、精成科技股份有限公司 6.83%、慶安投資股份有限公司 3.95%、中央投資股份有限公司 3.85%、信昌電子陶瓷股份有限公司 3.36%、華東科技股份有限公司 3.35%、瀚宇博德股份有限公司 2.91%、瀚宇彩晶股份有限公司 2.00%

4.董事資料(二)：

(1)董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

114 年 4 月 13 日

條件 姓名		專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董 事 長	焦佑衡	董事專業資格與經驗請參閱本年報第 3-4 頁董事資料 所有董事皆未有公司法第三十條各款情事(註 5)	不適用	0
董　　事	華新麗華(股)公司 代表人：焦佑倫			0
董　　事	華邦電子(股)公司 代表人：詹東義			0
董　　事	華新科技(股)公司 代表人：束耀先			0
董　　事	于鴻祺			0
獨立董事	呂禮正（註1）		所有獨立董事皆符合下述情形： 1. 符合證券交易法第十四條之二暨「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」(註 6)之相關規定 2. 本人（或利用他人名義）、配偶及未成年子女無持有本公司已發行股份總數 1%以上 3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額	0
獨立董事	郝海晏（註2）			0
獨立董事	林旺財（註3）			0
獨立董事	邱靖雅（註4）			1

註 1：93 年 6 月 24 日擔任獨立董事。
註 2：93 年 6 月 24 日擔任獨立董事。
註 3：108 年 6 月 25 日擔任獨立董事。
註 4：111 年 6 月 14 日擔任獨立董事。
註 5：有下列情事之一者，不得充任經理人，其已充任者，當然解任：
1. 曾犯組織犯罪防制條例規定之罪，經有罪判決確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾五年。
2. 曾犯詐欺、背信、侵占罪經宣告有期徒刑一年以上之刑確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年。
3. 曾犯貪污治罪條例之罪，經判決有罪確定，尚未執行、尚未執行完畢，或執行完畢、緩刑期滿或赦免後未逾二年者。
4. 受破產之宣告或經法院裁定開始清算程序，尚未復權者。
5. 使用票據經拒絕往來尚未期滿者。
6. 無行為能力或限制行為能力者。
7. 受輔助宣告尚未撤銷。

註 6：1. 非公司法第二十七條規定之政府、法人或其代表人。
2. 兼任其他公開發行公司之獨立董事，未逾三家。

3. 選任前二年及任職期間無下列情事之一：
   (1) 公司或其關係企業之受僱人。
   (2) 公司或其關係企業之董事、監察人。
   (3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
   (4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
   (5) 直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。
   (6) 與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。
   (7) 與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）或受僱人。
   (8) 與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東。
   (9) 為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

(2)董事會多元化及獨立性：

本公司董事會訂定「董事選舉辦法」，明訂董事(含獨立董事)候選人之提名、資格及評估之政策及標準，所有董事成員的提名皆經由嚴謹的遴選程序，不僅考量多元化背景、專業能力與經驗，也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。

本公司董事會成員組成多元化政策訂定於本公司「公司治理實務守則」第20條，內容如下：

董事會成員組成宜考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體具備之能力如下：

一、營運判斷能力。

二、會計及財務分析能力。

三、經營管理能力。

四、危機處理能力。

五、產業知識。

六、國際市場觀。

七、領導能力。

八、決策能力。

獨立董事席次依法應設置三人，本公司獨立董事為四人，超過法定目標，且全體獨立董事均未有證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，以健全公司經營發展及公司治理實務運作。本公司董事占比為 56%、獨立董事占比為 44%，其中具員工身份之董事占比為 22%，並包含一名女性董事；獨立董事中有 1 位任期年資在 3 年以下、有 1 位任期年資在 6 年以下，其餘 2 位獨立董事任期年資超過 6 年；目前女性董事占比為 11%，主係因產業女性比例偏低，未來將持續積極尋找相關人選及評估再增加女性董事成員之必要性及可行性，並適時調整董事會之組成，以健全董事會結構與運作，落實性別平等政策及提高女

性決策參與。本公司董事會成員均具有豐富之經營管理能力、領導決策能力，包括不同產業、商務及財務等專業之多元化背景，焦佑衡董事長長期耕耘於公司所營事業之相關領域並擅長營運管理及投資判斷；束耀先董事具有企管相關學經歷，故具有財務及投資之專業；焦佑倫董事、詹東義董事、于鴻祺董事、呂禮正獨立董事、郝海晏獨立董事、林旺財獨立董事、邱靖雅獨立董事均擁有相當豐富的公司經營管理經驗及能力，每位董事皆能夠提供公司不同面向之專業建議，因此本公司董事會具有相當的獨立性。

董事會成員落實多元化情形如下表：

職稱	董事長	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	焦佑衡	焦佑倫	詹東義	束耀先	于鴻祺	呂禮正	郝海晏	林旺財	邱靖雅
性別	男	男	男	男	男	男	男	男	女
年齡	61-70	61-70	61-70	71-80	61-70	61-70	61-70	71-80	51-60
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
兼任本公司員工	V				V				
具配偶及二親等以內親屬關係	二親等	二親等							
獨立董事任期年資						>9 年	>9 年	<6 年	<3 年
多元化核心項目									
經營管理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
領導決策	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業技術	V	V	V	V	V	V	V		
資訊科技	V		V		V	V	V		
市場行銷	V	V	V		V	V			V
財務會計				V		V		V	
國際觀	V	V	V	V	V	V	V	V	V

(二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

114 年 4 月 13 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註(註1)
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
總經理	中華民國	于鴻祺	男	91.8.1	1,708,508	0.33	0	0	0	0	史丹佛大學碩士 普林斯頓大學學士 友利電子總經理 華新科技監察人 元隆電子獨立董事	華東科技(蘇州)、華昕科技(蘇州)董事長 Walton Holding Universal Ltd.董事	無	無	無	無
副總經理	中華民國	高順隆	男	97.2.1	37	0.00	0	0	0	0	海洋學院輪機系 飛利浦建元電子經理	鑫豐科技董事長	無	無	無	無
副總經理	中華民國	張茂庭	男	103.6.19	105,003	0.02	0	0	0	0	中山大學資訊管理碩士 逢甲大學資訊工程學士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	黃靖窈	女	110.6.17	59,350	0.01	0	0	0	0	文化大學學士	華東科技(蘇州) 、鑫豐科技、華昕科技(蘇州)監察人	無	無	無	無
協理	中華民國	劉威吾	男	110.6.17	100,291	0.02	28,366	0.01	0	0	紐約州立大學碩士	無	無	無	無	無
協理	中華民國	林秀親	女	110.6.17	189,000	0.04	0	0	0	0	高雄醫學大學學士	無	無	無	無	註 2
協理	中華民國	李玉莉	女	110.6.17	98,162	0.02	0	0	0	0	中山大學碩士	無	無	無	無	無

註 1：公司董事長與總經理或相當職務者(最高經理人)為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施之相關資訊。

註 2：114 年 3 月 29 日解任，當年度股權變動情形結算至該日止。

(三) 一般董事、獨立董事、總經理及副總經理之酬金

1.一般董事及獨立董事之酬金

單位：新台幣仟元

職稱	姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金												A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F) (註)		員工酬勞(G)				員工認股權憑證得認購股數(H)		取得限制員工權利新股股數(I)				
																本公司		財務報告內所有公司								
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	
董事長	焦佑衡	0	0	0	0	3,011	3,011	498	498	3,509 2.61%	3,509 2.61%	23,976	27,526	99	99	2,084	0	2,084	0	0	0	0	0	29,668 22.10%	33,218 24.74%	58,230
董事	華新麗華(股)公司 代表人：焦佑倫																									
董事	華邦電子(股)公司 代表人：詹東義																									
董事	華新科技(股)公司 代表人：束耀先																									
董事	于鴻祺																									
獨立董事	呂禮正																									
獨立董事	郝海晏																									
獨立董事	林旺財																									
獨立董事	邱靖雅																									

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：本公司訂有「董事薪資報酬辦法」規範獨立董事之酬金給付標準，並依其個別貢獻度及績效表現，同時考量公司經營績效及未來風險之關聯合理性給付酬金。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：0

註：屬退職退休金費用化之提列或提撥數，無實際給付退職退休金金額。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	焦佑衡、華新麗華、華邦電子、華新科技、于鴻祺、呂禮正、郝海晏、林旺財、邱靖雅	焦佑衡、華新麗華、華邦電子、華新科技、于鴻祺、呂禮正、郝海晏、林旺財、邱靖雅	華新麗華、華邦電子、華新科技、呂禮正、郝海晏、林旺財、邱靖雅	華新麗華、華邦電子、華新科技、呂禮正、郝海晏、林旺財、邱靖雅
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元(不含)	-	-	-	-
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元(不含)	-	-	-	-
3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元(不含)	-	-	-	-
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元(不含)	-	-	-	-
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元(不含)	-	-	于鴻祺、焦佑衡	于鴻祺、焦佑衡
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元(不含)	-	-	-	-
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元(不含)	-	-	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含)	-	-	-	-
100,000,000 元以上	-	-	-	-
總計	9 人	9 人	9 人	9 人

2.總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)(註)		獎金及特支費等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、 C 及 D 等四項總額及占稅後純益之比例（%）				領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司		財務報告內所有公司		
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	總額	%	總額	%	
總經理	于鴻祺	11,540	12,875	452	452	11,170	12,237	0	0	0	0	23,162	17.25	25,564	19.04	0
副總經理	高順隆															
副總經理	張茂庭															

註：屬退職退休金費用化之提列或提撥數，無實際給付退職退休金金額。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元(不含)	-	-
2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元(不含)	-	-
3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元(不含)	-	-
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元(不含)	高順隆、張茂庭	高順隆、張茂庭
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元(不含)	于鴻祺	于鴻祺
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元(不含)	-	-
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元(不含)	-	-
50,000,000 元（含）～100,000,000 元(不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	3 人	3 人

3.分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形：最近年度盈餘分配股東會前經董事會通過擬議分派經理人之員工酬勞金額。

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱		姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經理人	執行長	焦佑衡	0	3,156	3,156	2.35
	總經理	于鴻祺				
	副總經理	高順隆				
	副總經理	張茂庭				
	協理	黃靖窈				
	協理	劉威吾				
	協理	林秀親				
	協理	李玉莉				

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

職稱	一一三年度		一一二年度	
	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司
董事	22.10%	24.74%	-422.51%	-501.17%
總經理及副總經理	17.25%	19.04%	-340.80%	-441.69%

1.本公司給付董事酬金之政策，係依據公司法及本公司章程規定，本公司年度如有獲利，得提撥不超過百分之二為董事酬勞。另依本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，參酌本公司經營策略、獲利狀況、未來永續發展及同業水準等因素，以及個別董事對本公司營運參與之程度及貢獻之價值(如擔任功能性委員會委員或受邀出席重要會議等)，給予合理報酬，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行。最近年度之董事報酬係依董事會決議每月給予車馬費，爾後公司有盈餘時，依章程規定分配，故酬金發放與經營績效成正相關。

2.總經理及副總經理之報酬，係依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，參酌本公司經營策略、經理人個人經營績效及目標達成率、對公司利潤貢獻度、營運管理能力、專業能力與市場競爭力、一般同業市場行情發放水準以及永續績效評估指標(財務績效 40%、市場與客戶 30%、永續發展績效 30%)等，由薪資報酬委員會提出建議案經董事會通過後執行，每年亦依據法令規定於年報中揭露給付金額，未來風險應屬有限。

二、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形：

最近年度(113)董事會共開會 6 次(A)，董事出列席情形如下。

1.董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出(列)席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率%(B/A)	備註
董事長	焦佑衡	6	0	100%	無
董事	華新麗華(股)公司 代表人：焦佑倫	5	1	83%	無
董事	華邦電子(股)公司 代表人：詹東義	6	0	100%	無
董事	華新科技(股)公司 代表人：束耀先	6	0	100%	無
董事	于鴻祺	6	0	100%	無
獨立董事	呂禮正	5	1	83%	無
獨立董事	郝海晏	6	0	100%	無
獨立董事	林旺財	5	1	83%	無
獨立董事	邱靖雅	6	0	100%	無

其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：本公司已設置審計委員會，不適用證券交易法第十四條之三規定，相關資料請參閱本年報「審計委員會運作情形」。

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無此情形。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形：

日期屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第十屆 第九次 113.01.31	焦佑衡 于鴻祺	本公司經理人「112 年度年終獎金案」	與董事自身有利害關係	不參與表決
第十屆 第十次 113.02.22	焦佑衡 束耀先	本公司捐贈「財團法人華科事業群慈善基金會」案	與董事自身有利害關係	不參與表決
第十屆 第十二次 113.04.29	焦佑衡 于鴻祺	本公司經理人 113 年第一季育才計劃獎金案	與董事自身有利害關係	不參與表決

日期屆次	董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形
第十屆 第十三次 113.08.01	焦佑衡 于鴻祺	本公司經理人之 113 年年中獎金案	與董事自身有利害關係	不參與表決
	焦佑衡 于鴻祺	本公司經理人 113 年度調薪案	與董事自身有利害關係	不參與表決

3.董事會評鑑執行情形：

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
每年一次	113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日	整體董事會	董事會 內部自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制
		個別董事成員	董事 成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
		審計委員會 薪資報酬委員會	董事會 內部自評	對公司營運之參與程度、審計/薪資報酬委員會職責認知、提升審計/薪資報酬委員會決策品質、審計/薪資報酬委員會組成及成員選任、內部控制

4.當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：

(1)本公司網站及公開資訊觀測站均揭露本公司遵循之相關法規、董事會重大決議等相關資訊，以利股東瞭解公司動態，提升公司資訊透明度。

(2)自 108 年 6 月 25 日之股東常會後正式設立審計委員會替代監察人職權，亦自 108 年 6 月 25 日起薪資報酬委員會過半數成員由獨立董事擔任，透過上述之功能性委員會持續協助董事會履行監督職責。

(3)為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，爰依上市上櫃公司治理實務守則訂定本公司董事會績效評估辦法，適用全體董事會、各功能性委員會及個別董事。本公司董事會績效評估辦法訂於 109 年 5 月 4 日，最近期修訂業經 109 年 7 月 31 日董事會決議通過，並於當年度實行。董事會及各功能委員會之內部自評方式為，議事單位應於每年 12 月間提供問卷供董事成員填寫；並提供董事會議事單位已填妥之附件及與績效評估

相關之資訊，供董事成員參考。

本公司 113 年度董事會績效內部評估結果如下：

A.董事會績效自評整體平均分數：4.92 分(滿分 5 分)

B.董事會成員自評整體平均分數：4.97 分(滿分 5 分)

(4)本公司功能性委員會參照主管機關公布之最新版本所訂定之「董事會績效評估辦法」，於每年 12 月依評鑑指標自行評估，衡量在領導公司的策略方向及監督公司營運管理之運作績效。

本公司 113 年度功能性委員會績效內部評估結果如下：

A.審計委員會績效自評整體平均分數：5 分(滿分 5 分)

B.薪資報酬委員會績效自評整體平均分數：5 分(滿分 5 分)

(5)本公司除於公司章程明定董事會職權外，並訂有「董事會議事規則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「申請暫停及恢復交易作業程序」、「處理董事要求之標準作業程序」、「公司治理實務守則」、「公司誠信經營行為守則及作業程序」、「永續發展實務守則」等公司治理相關規章，以強化董事會之運作及公司治理。

(二) 審計委員會會運作情形：

1. 審計委員會會運作情形：

(1) 審計委員會職權及年度工作重點

A.職權事項：

(a) 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

(b) 內部控制制度有效性之考核。

(c) 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

(d) 涉及董事自身利害關係之事項。

(e) 重大之資產或衍生性商品交易。

(f) 重大之資金貸與、背書或提供保證。

(g) 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

(h) 簽證會計師之委任、解任或報酬及其獨立性及適任性之評估。

(i) 財務、會計或內部稽核主管之任免。

(j) 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

(k) 其他公司或主管機關規定之重大事項。

B.年度工作重點：

(a) 依法辦理審計委員會會議之相關事宜(議事安排、會議通知、議事錄)。

(b) 審計委員會要求改善事項之追蹤與執行。

(c) 提供獨立董事所需之公司資料協助其充分行使職權。

(d) 建立與修訂組織規程及相關作業辦法。

(e) 審計委員會年度自評作業。

(f) 審議各季財務報告。

(g) 審議重大之資金貸與及背書保證。

(h) 依法公告申報審計委員會相關事項(組織規程、運作情形)。

(2) 第二屆審計委員會任期自 111 年 6 月 14 日至 114 年 6 月 13 日，截至 114 年 4 月 29 日，共計已開會 8 次。

113 年度審計委員會共計開會 5 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	呂禮正	4	1	80%	-
委員	郝海晏	5	0	100%	-
委員	林旺財	4	1	80%	-
委員	邱靖雅	5	0	100%	-

114 年度審計委員會共計開會 3 次(A)，獨立董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	呂禮正	3	0	100%	-
委員	郝海晏	3	0	100%	-
委員	林旺財	3	0	100%	-
委員	邱靖雅	3	0	100%	-

(3) 其他應記載事項：

A. 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(a)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期、期別	議案內容	獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
第二屆第八次 113.02.22	本公司 112 年度內控聲明書案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司 112 年度營業報告書及財務決算表冊案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司變更委任簽證會計師案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司評估簽證會計師之獨立性、適任性及委任 113 年度簽證會計師案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	修訂本公司「背書保證作業程序」	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第二屆第九次 113.03.27	謹造具本公司 112 年度盈餘分配表案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第二屆第十次 113.04.29	修訂本公司「股務作業」內部控制制度	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司 113 年第一季合併財務報表	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第二屆第十一次 113.08.01	本公司 113 年第二季合併財務報表	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第二屆第十二次 113.10.30	本公司 113 年第三季合併財務報表	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	資金貸與子公司華東科技(蘇州)有限公司美金 32,000,000 元案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	資金貸與孫公司鑫豐科技有限公司美金 5,000,000 元，及為其於新台幣 12.15 億元等值外幣內提供背書保證案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	增訂本公司「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則案	無	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

(b)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無此情形。

B. 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。

C. 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

(a)本公司已成立審計委員會，並由全體獨立董事組成；每年至少二次邀請簽證會計師列席審計委員會，針對本公司及子公司財務報告核閱或查核結果及內控查核情形向審計委員會報告，並就有無重大調整分錄

或法令修訂有無重大影響進行充分溝通，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。

(b)審計委員會參酌專業會計師查核後之本公司合併財務報表及查核意見書報告完成審查。

(c)內部稽核單位依年度稽核計劃確實執行查核作業，內部稽核主管於稽核項目(或追蹤項目)完成之次月檢送書面報告呈核獨立董事告，若有特殊狀況時，亦會即時向審計委員會委員報告，113 年度並無上述特殊狀況。本公司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。

(d)本公司 113 年度獨立董事與會計師溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨立董事建議	處理執行結果
113.1.31 董事會	審計品質指標(AQI)及關鍵查核事項	無	無意見
113.2.22 審計委員會	112 年度營業報告書及財務決算表冊	無	皆經審計委員會審閱或核准通過
113.4.29 審計委員會	113 年第一季合併財務報表	無	皆經審計委員會審閱或核准通過
113.8.1 審計委員會	113 年第二季合併財務報表	無	皆經審計委員會審閱或核准通過
113.10.30 審計委員會	113 年第三季合併財務報表	無	皆經審計委員會審閱或核准通過

(e)本公司 113 年度獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：

日期	溝通重點	獨立董事建議	處理執行結果
113.2.22 審計委員會	1.112 年第 4 季稽核計劃執行情形報告 2.審議 112 年度「內部控制制度聲明書」案	無	皆經審計委員會審閱或核准通過
113.4.29 審計委員會	1.113 年第 1 季稽核計劃執行情形報告 2.審議內部控制制度及內部稽核制度修訂案	無	皆經審計委員會審閱或核准通過
113.8.1 審計委員會	1.113 年第 2 季稽核計劃執行情形報告	無	皆經審計委員會審閱或核准通過
113.10.30 審計委員會	1.113 年第 3 季稽核計劃執行情形報告 2.審議內部控制制度及內部稽核制度修訂案 2.審議 114 年度稽核計劃案	無	皆經審計委員會審閱或核准通過

(三) 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？	是		公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定本公司之「公司治理實務守則」，並揭露於公開資訊觀測站及本公司網站。	無重大差異。
二、公司股權結構及股東權益				
(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施?	是		(一)本公司設有發言人及股務專人處理股東建議或糾紛等問題。	無重大差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	是		(二)本公司依相關法令規定定期揭露主要股東之最終控制者名單。	
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?	是		(三)本公司與關係企業之財產、財務會計皆為獨立作業，並依據相關規定，制定書面辦法並遵循之。	
(四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?	是		(四)為建立公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制、避免資訊不當洩漏及防範內線交易，本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」，以資遵循；並定期提供相關法規予內部人參閱，並於內部人新任時，依相關法規規定提供相關資料及取得其聲明書。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、董事會之組成及職責 (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？	是		(一)本公司訂定之「公司治理實務守則」已明訂董事成員組成之多元化政策，並接露於公司網站及公開資訊觀測站，且董事會成員具備財務、產業、科技等不同專業背景及工作領域，未來亦會朝向性別多元化之方向前進，落實推動我國性別平等政策綱領。董事會成員落實多元化情形說明如註1。	無重大差異。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？		否	(二)本公司目前尚未設置，未來將依主管機關規定設置。	
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	是		(三)依本公司「董事會績效評估辦法」，於每年12月就董事會、董事成員及功能性委員會(薪酬委員會/審計委員會)以問卷方式進行績效評估，評估結果由董事會議事單位彙總後提報董事會，並作為提名董事續任之參考之一。	
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	是		(四)本公司會要求簽證會計師提供「超然獨立聲明書」以及「審計品質指標(AQIs)」外，簽證會計師均經審計委員會及董事會定期評估其獨立性及適任性並決議聘任之，最近一次評估經114年2月20日審計委員會決議通過後，並提報114年2月20日董事會決議通過，會計師獨立性評估項目如註2。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	是		本公司已於109年11月6日董事會通過設置公司治理主管，主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、其他依公司章程或契約所訂定之事項等，本公司現任公司治理主管由黃靖窈協理擔任，其具備公開發行公司從事財務主管職務經驗達三年以上，符合公司治理主管之法定資格。亦於108年5月2日董事會通過「處理董事所提出要求之標準作業程序」，使董事執行業務所需之資料有合宜的作業處理規範。公司治理主管進修情形如註3。	無重大差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	是		本公司設置專責人員與利害關係人及股東保持適當聯繫。	無重大差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	是		本公司設有股務辦事處辦理股東會事務。	無重大差異。
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	 是 是		 (一)財務業務及公司治理等相關資訊已於本公司網站投資人專區揭露，並依規定於公開資訊觀測站揭露相關資訊。 (二)本公司由專人負責公司資訊之蒐集及揭露，並設置發言人，以落實發言人制度；不定期召開法人說明會，並於本公司網站及公開資訊觀測站揭露。	無重大差異。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告,及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？		否	(三)財務報告與各月份營運情形皆於規定期限內公告申報。	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？	是		1. 召開董事會時，董事出席人數均依公司法之規定。 2. 本公司「董事會議事規則」中明訂，董事應秉持高度自律，對董事會所列之議案涉有董事本身或其代表之法人利害關係至損及公司利益之虞時，應自行迴避亦不得代理其他董事加入表決；董事間亦應自律，不得相互支援。董事如有違反迴避事項而加入表決之情形者，其表決權無效。 3. 本公司已為董事購買責任保險。 4. 本公司董事不定期參與公司治理相關進修課程(註4)。	無重大差異。
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列) 1. 已改善情形如下： 公司網站持續更新董事會、股東會、法說會及財務報表等相關資訊供投資人參閱，以利投資人瞭解公司動態，提升公司資訊透明度。 2. 待改善情形如下： 公司仍持續致力於董事會成員多元化、提高全體董事之出席率及請董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規範完成年度進修時數。				

註 1：

職稱	董事長	董事	董事	董事	董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事	獨立董事
姓名	焦佑衡	焦佑倫	詹東義	東耀先	于鴻祺	呂禮正	郝海晏	林旺財	邱靖雅
性別	男	男	男	男	男	男	男	男	女
年齡	61-70	61-70	61-70	71-80	61-70	61-70	61-70	71-80	51-60
國籍	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國	中華民國
兼任本公司員工	V				V				
具配偶及二親等以內親屬關係	二親等	二親等							
獨立董事任期年資						>9 年	>9 年	<6 年	<3 年
多元化核心項目									
經營管理	V	V	V	V	V	V	V	V	V
領導決策	V	V	V	V	V	V	V	V	V
產業知識	V	V	V	V	V	V	V	V	
產業技術	V	V	V	V	V	V	V		
資訊科技	V		V		V	V	V		V
市場行銷	V	V	V		V	V			V
財務會計				V		V		V	
國際觀	V	V	V	V	V	V	V	V	V

註 2：

評估項目	評估結果	是否符合獨立性
截至最近一次簽證作業，未有七年未更換之情事。	是	是
與委託人無重大財務利害關係。	是	是
避免與委託人有任何不適當關係。	是	是
會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。	是	是
執業前二年內服務機構之財務報表，不得查核簽證。	是	是
會計師名義不得為他人使用。	是	是
未握有本公司及關係企業之股份。	是	是
未與本公司及關係企業有金錢借貸之情事。	是	是
未與本公司或關係企業有共同投資或分享利益之關係。	是	是
未兼任本公司或關係企業之經常工作，支領固定薪酬。	是	是
未涉及本公司或關係企業制定決策之管理職能。	是	是
未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。	是	是
與本公司管理階層人員無配偶或二親等以內之親屬關係。	是	是
未收取任何與業務有關之佣金。	是	是
截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。	是	是

註 3：公司治理主管進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
公司治理主管	黃靖窈	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/09/11	工業技術研究院/中國信託銀行	淨零永續 2024 關鍵行動論壇	6
		113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3

註 4：公司董事進修情形

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	焦佑衡	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024 年台灣經濟走勢分析	3
		113/05/03	社團法人中華公司治理協會	鎳產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理	3
		113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	3
		113/11/06	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	碳權交易機制與碳管理應用	3
		113/11/08	社團法人中華公司治理協會	台灣線纜事業發展與前景暨營造友善職場(含性騷擾防治)	3
董事	詹東義	113/03/14	社團法人中華公司治理協會	生成式AI的機會與挑戰;善用氣候法制經濟工具因應範圍三減碳挑戰	3
		113/03/14	社團法人中華公司治理協會	亂世繁花:當前經濟形勢與地緣政治下矛盾對話;來自天堂的音樂使者	3
		113/08/08	社團法人中華公司治理協會	從知名跨國企業的成長歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰	3
		113/08/08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事	于鴻祺	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	從知名跨國企業的成長歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰	3
		113/08/08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5
		113/11/14	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維/生成式 AI 應用與管理趨勢	3
董事	焦佑倫	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024 年台灣經濟走勢分析	3
		113/03/29	社團法人中華公司治理協會	高值化鋼品的生產技術與市場發展	2
		113/05/03	社團法人中華公司治理協會	鎳產業發展前景暨韌性供應鏈永續管理	3
董事	束耀先	113/10/07	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習-2024 台新淨零高峰論壇	3
		113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	呂禮正	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024 年台灣經濟走勢分析	3
		113/11/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	公司治理與證券法規-公司治理下董監和內部人所不可不知的法律規範與風險責任	3
		113/11/12	社團法人中華民國公司經營暨永續發展協會	企業併購實務與法律議題	3
獨立董事	郝海晏	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024 年台灣經濟走勢分析	3
		113/11/22	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3
獨立董事	林旺財	113/01/26	社團法人中華公司治理協會	2024 年台灣經濟走勢分析	3
		113/03/22	企業永續發展協會	「以永續知識力打造全新碳時代」CDP 台灣發表會	3
獨立董事	邱靖雅	113/03/12	社團法人中華公司治理協會	公司誠信經營與高階當責制度國際趨勢與經驗分享	3
		113/03/26	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3

(四) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形：

1.薪資報酬委員會成員資料：

114 年 4 月 13 日

<table>
<tr><td colspan="2">條件
身分別 姓名</td><td>專業資格與經驗</td><td>獨立性情形</td><td>兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數</td></tr>
<tr><td>獨立董事</td><td>呂禮正</td><td rowspan="2">本公司薪酬委員會由兩位獨立董事及一位外部人士組成，委員-獨立董事部份之專業資格與經驗本年報第 3-4 頁董事資料</td><td rowspan="3">所有薪酬委員會委員皆符合下述情形：
1.符合金融監督管理委員會頒訂之證券交易法第十四條之六暨「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」(註)相關規定
2.本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女無持有本公司已發行股份總數 1%以上
3.最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額</td><td>0</td></tr>
<tr><td>獨立董事</td><td>郝海晏</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>陳逸民</td><td>主要經(學)歷：
國立中興大學應用數學系學士
台灣惠普科技人力資源處經理
華新麗華人事部協理
目前兼任本公司及其他公司之職務：
精成科技、瀚宇博德、閎暉實業薪資報酬委員會委員</td><td>3</td></tr>
</table>

註：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

(1)公司或其關係企業之受僱人。

(2)公司或其關係企業之董事、監察人。

(3)本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數 1%以上或持股前十名之自然人股東。

(4) (1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。

(5)直接持有公司已發行股份總數 5% 以上、持股前五名或依公司法第二十七條指派代表人擔任公司董事之法人股東之董事、監察人或受僱人。

(6)與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。

(7)與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人（監事）或受僱人。

(8)與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股 5%以上股東。

(9)為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額逾新台幣五十萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但擔任本公司薪酬委員會成員者，不在此限。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊：

(1) 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人，薪資報酬委員會之職責為負責定期檢討委員會組織規程、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策及薪資報酬。

(2) 第 5 屆薪資報酬委員會任期自 111 年 6 月 14 日至 114 年 6 月 13 日，截至 114 年 4 月 29 日，共計已開會 7 次。

113 年度薪資報酬委員會共計開會 3 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	郝海晏	3	0	100%	-
委員	呂禮正	3	0	100%	-
委員	陳逸民	3	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

114 年度薪資報酬委員會共計開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	郝海晏	4	0	100%	-
委員	呂禮正	4	0	100%	-
委員	陳逸民	4	0	100%	-

其他應記載事項：

一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

二、薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(3) 薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

薪酬委員會日期、期別	議案內容	薪酬委員會決議結果	公司對薪酬委員會意見之處理
第五屆第七次 113.01.31	本公司經理人「112 年度年終獎金案」	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第八次 113.04.29	本公司經理人 113 年 Q1 育才計劃獎金案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第九次 113.08.09	本公司經理人「113 年年中獎金案」	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司經理人調薪案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第十次 114.01.17	本公司 113 年度員工及董事酬勞之提列比率	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司經理人「113 年度年終獎金案」	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司經理人減薪案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第十一次 114.02.20	本公司經理人任用案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第十二次 114.03.27	訂定本公司基層員工範圍案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
第五屆第十三次 114.04.29	本公司董事「113 年度董事酬勞分派案」	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司經理人「113 年度員工酬勞分派案」	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過
	本公司經理人 114 年 Q1 育才計劃獎金案	全體出席委員同意通過	全體出席董事同意通過

(五) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	是		1. 遵循本公司ESG政策的願景與使命，於111年成立「永續發展委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由總經理擔任主任委員，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。 2.「永續發展委員會」經由定期會議及依議題而設的功能小組，統籌及督導相關單位執行相關作業進度。擬定因應行動方案及預算。其於召開管理審查會議審視永續落實之情況與結果。且針對當年度出版之永續報告書及追蹤績效建立持續改善計畫。「永續發展委員會」每年第四季(至少一年一次)向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。在113年度召開之會議，議案內容包含： (1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案。 (2)永續相關議題之目標及政策修訂，監督並評估執行情形。 3. 公司董事會每年第四季(至少一年一次)定期聽取經營團隊的報告(包含ESG報告)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。	無重大差異。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</td><td>是</td><td></td><td>1.本揭露資料涵蓋公司於113年1月至113年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣、中國大陸據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將華東科技(蘇州)有限公司列入範疇。
2.永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之ESG議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。
3.依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下:
<table>
<tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說　明</th></tr>
<tr><td>環境永續</td><td>環境衝擊項目</td><td>1.本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環有效地降低汙染的排放及對環境的衝擊。並於89年起取得ISO14001之環境及能源管理認證，後持續迄今。
2.本公司於110年11月開始依據PAS2050＆ISO14067之內進行碳盤查，盤查邊界包含了原物料、製造等兩個階段。從原料到製造處理過程所產生之碳排放量，並委託公正第三方台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司(TUV)進行外部查證作業。</td></tr>
</table></td><td>無重大差異。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說　　明</th></tr>
<tr><td>環境永續</td><td>環境衝擊項目</td><td>3.華東科技制訂有材料環境管理物質之管理通則，針對原料及相關物料之來源做有效的內部控管，符合RoHS2.0、REACH、China RoHS..等國際法規，以達到綠色產品之標準，且減低產品對自然環境之影響，華東科技並訂定有危害物質管理政策。
4.華東科技各廠區皆已導入有害物質流程管理系統並通過IECQ QC080000認證，進行有效監督與控管。對於危害物質的認識，透過訓練的方式，讓每位員工都能夠確實瞭解其危害、如何防護及緊急應變的程序，將其充分訓練與落實在工作環境中。
5.年度規劃內部稽核計畫，針對本公司須遵守各項環境法規之合規情形及各作業流程稽查。皆以符合現行法規要求。</td></tr>
<tr><td>社會</td><td>職業安全</td><td>華東科技為推動全體員工實際參與並落實職業健康安全，設置「職業安全衛生委員會」負責規劃、辦理安全衛生相關業務，由總經理擔任主任委員，其中勞方代表8人占比38%。每季召開一次會議，113年共召開4次會議。華東科技每年定期執行職安衛訓練、緊急應變模擬演練、疏散演練以強化員工職安衛意識及緊急應變能力。</td></tr>
</table>
</td><td>無重大差異。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說　明</th></tr>
<tr><td>社會</td><td>產品安全</td><td>本公司各產品皆遵守政府規範及環保法規,同時為確保客戶服務品質。特別針對策略性客戶設立跨部門的專屬客服小組，為客戶協調並掌握從產品開發、量產出貨、品質控管改善的每項細節，以最適溝通介面提供最高價值的服務，達成雙方之共同目標。
此外，華東科技運用網路科技提供「虛擬工廠」的資訊平台，讓客戶端可隨時掌握所有動態，大幅簡化其供應鏈管理之作業。</td></tr>
<tr><td>公司治理</td><td>社會經濟及法令遵循</td><td>1.本公司在國內外相關法規的部份除均依循規範辦理外，並隨時注意所處產業之國內外政策發展趨勢及法規變動情形，最近年度國內外重要政策及法律變動並未對華東科技財務業務產生影響。另外在訴訟或非訟事件部份，華東科技截至最近年度止，並無已判決確定或目前尚在進行中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響之事件。亦無公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司最近年度及本報告書刊印日止已判</td></tr>
</table>
</td><td>無重大差異。</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
					決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響之事件。 2.有關華東科技之反貪瀆政策規定於華東科技之廉潔條款中，要求所有員工應承諾不得自供應商、客戶或其他交易對象接受金錢回扣、饋贈、招待或獲取其它利益，並訂定限額。嚴格禁止貪瀆收受賄賂之行為發生，如有發生，則依相關懲戒規定辦理。 3.本公司產品及流程等營業秘密皆已申請專利或簽訂保密切結書守護。	無重大差異。
			公司治理	強化董事職能	本公司董事會係依據政府法令規定以及公司內部訂定之董事會議事規則進行運作，九位董事分別具有不同領域之專業。除成員多元化，每年並依規定進行專業進修。因此董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標。	
				利害關係人溝通	本公司透過多種不同溝通管道收集各利害關係人之意見。對象涵蓋企業客戶、員工、供應商、一般股東、社區社群非營利組織。積極溝通以減少誤解或對立。並設有投資人信箱由發言人處及回應，於每年第四季向董事會報告與利害關係人溝通情形。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？ (四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	是 是 是 是		(一) 本公司為半導體封裝測試產業，也陸續完成ISO14001、ISO45001、QC08000等環境及職安衛管理系統之認證，建立一個對環境友善及優質安全健康之作業環境。 (二) 本公司致力於提升各項資源使用效率，並取得QC080000證書，滿足有關有害物質管理的相關國際標準、法規和客戶特定要求，對於構成產品之材料進行評估分類與管理，以了解其有害物質之含量避免對環境造成污染以及危害人體健康，以達成環境永續之願景。 (三) 本公司在氣侯變遷的議題因應上，我們陸續完成LED照明更新、耗能設備汰換、太陽能建置及廢棄物減量提高回收再利用率等措施，為永續環境發展盡一份心力。 (四) 本公司於2011年起實施溫室氣體盤查及查證作業，也從盤查結果中了解碳排放之熱點，並同時擬定相對應節能減碳、用水回收及廢棄物減量提高再利用之相關計劃，以符合公司環境政策及ESG短中長期目標。	無重大差異。
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	是		(一) 恪遵各項法令並根據政府勞動法規及成立自主工會保障員工之合法權益且實施RBA制度(支持並遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球約》、《國際勞動組織公約》等各項國際社會公認之人權公約及准則)。雇用員工皆依就業服務法及性別工作平等法規定辦理。除榮獲行政院勞委會縣市級友善職場獎項。也自民國101年至107年及109年至112年連續獲得經濟部加工出口區頒發之勞資關係優良獎及熱心公益貢獻獎。亦於113年完成全員RBA教育訓練，提升每位同仁關注人權保障議題及降低公司發生相關風險的可能性。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	是		(二) 本公司設有薪酬委員會，負責管控公司內部薪資報酬平衡機制。我們的薪資結構設計，除依據中華民國勞動部頒布之「基本工資」為基礎外，更納入同業敘薪資料作為參考，以確保員工之薪資具外部競爭性。另外，我們亦採取「同工同酬」之概念。職場朝向性別平等、多元尊重的社會邁進，113 年女性經理人平均佔比 38%，女性員工平均佔比 54%。 每年度皆可享有員工旅遊、三節禮券、秋季活動、免費停車場、婚喪節慶補助、女性專屬哺乳室、員工餐廳、特約廠商消費優惠、員工團體保險、定期健康檢查等專屬福利。	無重大差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	是		(三) 本公司依勞工安全衛生法之規定辦理員工體檢並舉辦健康相關訓練。並先後已通過ISO 14001及、ISO45001等環保工業安全之認證，建立一個環保安全優質作業環境。每年針對全體員工進行消防安全演練，並指派各樓層區域指揮官進行消防緊急應變措施。113年度職災件數為1件(受傷人員：1人，佔員工總人數0.06%)，已加強作業宣導以降低職災再發生；火災事故為0件。	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	是		(四) 本公司重視人才的培育，於每年度皆按經營方針、客戶要求與各部門需求，擬定該年度訓練計畫，依功能面擬定內外部講師、必修人員及選修人員。除了整體之年度訓練計畫外，各部門亦會依自身需求展開部門在職訓，依各個同仁程度量身訂做，發展適合個人之職能地圖。113年全體員工參與受訓人次25,923人，總受訓時數達30,922小時。同時，為鼓勵員工持續進修與工作相關領域之技能與知識，公司亦提供進修獎學金。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	是		(五) 本公司產品及服務之行銷與標示，皆遵循本國及銷售地之法規及國際準則。並擁有ISO27001國際資訊安全系統標準，協助企業建立、實施、維護、持續改善，以確保客戶及供應商資訊安全保護。本公司生產之產品，非終端產品，無直接接觸消費者。	無重大差異。
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	是		(六) 本公司致力於成為企業永續經營重要議題的倡議者，營造對環境及社會負責任的營運模式，以期發揮半導體產業業者的永續影響力。除遵循 RBA 行為準則來評估營運中之勞工、環境、健康安全、商業道德與管理體系，拓展至供應商的永續性管理。為了確保供應商工作環境的安全、保障員工的權益受到尊重、落實環保並遵守道德操守，不允許供應商僱用童工或強迫性勞動，如有情節重大違規將終止往來。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	是		本公司編制永續報告書係參考國際通用之 GRI 編製準則或指引編制而成，每年定期揭露於本公司網站。目前本公司永續報告書並無取得第三方驗證單位之確信。	無重大差異。

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，並達永續發展之目標，於109年7月31日依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定「永續發展實務守則」並由董事會決議通過生效及於112年2月22日修正實務守則條文內容，亦已將守則揭露於公開資訊觀測站，實際運作情形與守則並無重大差異。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

本公司恪遵相關勞動法規，保障員工之合法權益及建立環保安全優質的作業環境予員工之情形，請參閱本年報「肆、營運概況-勞資關係」。

（六）上市上櫃公司氣候相關資訊：

1.氣候相關資訊執行情形：

項目	執行情形
(1)敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	本公司由各項氣候風險與機會的對應部門，依據現況與趨勢進行重大氣候相關風險與機會辨識，完成辨識後共同討論擬定全公司氣候相關治理策略，透過定期召開之高階主管管理會議，討論及訂定管理對策及公司內部相關管理追蹤指標，視情況將公司所面臨的重大風險報告給董事會。
(2)敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短、中、長期)。	定義短期為未來1~3年、中期為未來3~5年、長期為未來5年以上。針對衝擊程度高且發生可能性高的主要氣候風險與機會，評估可能產生之潛在財務面與營運面影響，並擬訂因應計劃。短期氣候風險以碳稅/碳費徵收為例，預期將增加間接成本，如上游供應商將其相關支出轉嫁，導致採購成本增加，致使獲利下降。短期氣候機會以參與再生能源計畫為例，採購再生能源有助於分散購電成本及用電風險，亦可減少溫室氣體排放，進而減少碳稅/碳費支出。
(3)敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	因氣候變遷加劇，極端氣候造成降雨不均，水資源短缺可能影響廠區營運及製程，連帶影響產能與交期，並使營收受衝擊，未來法規修正，企業將被徵收碳稅/碳費，本公司間接成本將會增加，故華東致力於製程改善以減少溫室氣體用量，包括機台端加速汰換節能元件與設備、持續執行生產機台與廠務設施節能專案，雖導入新節能設備使資本支出增加，但可減少碳稅/碳費支出。
(4)敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。	透過各部門針對其負責之作業範疇進行風險管理，訂定相關之內部管理辦法及作業程序，並業將氣候變遷風險納入企業長期營運風險管理。
(5)若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	● 依據政府淨零路徑，評估國內法規之風險。 ● 為符合法規要求而需繳交碳稅/碳費對財務之衝擊。
(6)若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	華東積極推動碳中和以減緩氣候變遷，亦積極推動各廠區逐步於2050年達到淨零排放，並設定氣候相關目標，包括溫室氣體排放量減量、逐年提高再生能源電力占比。
(7)若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	113年未使用內部碳定價。

(8)若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。

氣候相關目標之活動

範疇1：以電換油，逐步汰換柴油車

範疇2：廠務節能措施、汰換高耗能廠務設備、太陽能建置、購買綠能(電證合一)

範疇3：增加廢棄物回收率

高雄廠區	110年(基準年)	113年
範疇一	2,831	預計114年6月底前完成確信
範疇二	99,810	預計114年6月底前完成確信
範疇三	115,934	預計114年6月底前完成確信
合計	218,575	預計114年6月底前完成確信

113年因使用再生能源電力(風力轉供及太陽能發電)，取得再生能源憑證(T-RECs) 1,379張

(9)溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫

1.最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形

1.1 溫室氣體盤查資訊

113年度

範疇別	公司別	總排放量(公噸CO2e)	密集度(公噸CO2e/百萬元)
範疇一	本公司	3,935	預計114年6月底前完成確信
範疇二	本公司	78,112	預計114年6月底前完成確信
範疇三	本公司	18,420	預計114年6月底前完成確信

112年度

範疇別	公司別	總排放量(公噸CO2e)	密集度(公噸CO2e/百萬元)
範疇一	本公司	520	0.97
範疇二	本公司	76,615	19.32
範疇三	本公司	17,080	4.56

1.2 溫室氣體確信資訊

113年度

範疇別	公司別	確信機構	確信情形說明
範疇一	本公司	TUV 台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	預計114年6月底前完成確信
範疇二	本公司	TUV 台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	預計114年6月底前完成確信
範疇三	本公司	TUV 台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	預計114年6月底前完成確信

112年度

範疇別	公司別	確信機構	確信情形說明
範疇一	本公司	TUV 台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，520公噸CO2e(佔總排放量之0.55%)經確信機構採ISO14064-1:2018準則確信，確信意見為合理保證。
範疇二	本公司	TUV 台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，76,615公噸CO2e(佔總排放量之81.32%)經確信機構採ISO14064-1:2018準則確信，確信意見為合理保證。
範疇三	本公司	TUV 台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	本公司揭露溫室氣體總排放量中，17,080公噸CO2e(佔總排放量之18.13%)經確信機構採ISO14064-1:2018準則確信，確信意見為有限保證。

2.溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

本公司溫室氣體的範疇一與範疇二排放源主要為柴油與外購電力，從用電能源效率提升、更換節能設備、設置太陽能發電及購買再生能源使用為主要策略規劃。透過ESG永續委員會整合各部門節能減碳之方案，執行減量計畫，並定期召開會議檢視執行情況，以達到2050年淨零排放的目標。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案				
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	是		(一) 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」新訂定「公司誠信經營行為守則及作業程序」，透過公司治理、風險控管機制及完善之內部規章，防範不誠信行為之發生，以創造良好永續經營之經營環境。	無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	是		(二) 本公司訂有「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」、「資金貸予他人作業程序」、「內部重大資訊處理作業程序」、「員工工作規則」等辦法，對於作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度等皆有清楚規範，與關係人之交易亦依相關規定辦理，以防範不誠信行為。	
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	是		(三) 本公司訂定「公司誠信經營行為守則及作業程序」、「申訴與舉報管理辦法」、「內部重大資訊處理作業程序」、「員工工作規則」等辦法，明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，及定期查核評估防範措施是否有效運作之機制，藉以規範同仁所需遵循之企業行為準則，並進行相關訓練，亦定期向公司員工進行防範內線交易宣導，避免誤蹈內線交易法網。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、落實誠信經營				
(一) 公司是否評估往來對象之誠信記錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	是		(一) 公司於進行商業往來之前，會審慎考量交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，與供應商交易時，均簽訂廉潔承諾書，以防範不誠信行為發生。	無重大差異。
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	是		(二) 本公司由行政部負責推動企業誠信經營，每年將會定期向董事會報告執行情形(已於113年10月30日董事會報告誠信經營宣導、受訓人數、時數等執行情形)。	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	是		(三) 公司相關內部規章與員工公司工作守則均公佈於公司內部網站，並於修訂時函知全體同仁。	
(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	是		(四) 公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並訂定相關作業辦法，隨時依法令規定或實際作業需要進行檢討及修正。公司經理人、內部各單位及子公司與稽核單位每年應至少辦理自行檢查內部控制制度一次，並作成報告，確實執行控制制度自行檢查。稽核單位依董事會通過之年度稽核計劃確實執行查核作業，稽核主管於稽核項目(或追蹤項目)完成之次月送交報告供監察人查閱，列席公司董事會報告稽核業務，並定期向監察人報告年度稽核業務及年度自行檢查內部控制制度作業。	
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	是		(五) 目前每年會對全體同仁進行一次教育訓練宣導。	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、公司檢舉制度之運作情形 (一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	是 是 是		(一) 本公司設有多元檢舉及申訴管道，如電子郵件、員工意見箱、申訴管道等及相關懲戒措施，並不定期檢討修正，以達有效及充分意見溝通之管道，使問題發生時，得以快速及有效溝通解決。 (二)有訂定申訴及舉報程序書，其中有調查標準作業程序及相關保密規定。 (三) 對任何檢舉案件均以密件方式建檔專案處理，並指派專責人員處理，確保利害關係人之隱私。	無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效?	是		本公司已於公司網站及公開資訊觀測站揭露「公司誠信經營行為守則及作業程序」，且公司RBA政策中制定「道德政策」，再次宣示公司對於誠信、廉潔、禁止關係人內線交易等相關要求，除了內部員工宣導及遵行外，亦一併向華東所有客戶及供應商宣示，期望共同體現廉潔、誠信的社會觀感，傳達給社會大眾值得信賴的企業精神。	無重大差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司確實遵守國內法令，並要求員工恪遵相關稽核、內控及相關內部規章，依據「上市上櫃公司誠信經營守則」作為落實誠信經營之依據，與「上市上櫃公司誠信經營守則」無重大差異。

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：

本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提升公司誠信經營之成效。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

本公司經理人(包括總經理、副總經理、會計、財務、內部稽核主管等)最近年度參與涵蓋公司治理主題相關之進修情形如下：

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
總經理	于鴻祺	113/08/08	社團法人中華公司治理協會	從知名跨國企業的成長歷程探討企業經營的挑戰和因應/氣候變遷與企業永續的趨勢與挑戰	3
		113/08/08	社團法人中華公司治理協會	全球經濟展望	1.5
		113/11/14	社團法人中華公司治理協會	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維/生成式 AI 應用與管理趨勢	3
會計主管	黃靖窈	113/07/03	臺灣證券交易所	2024 國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6
		113/09/11	工業技術研究院/中國信託銀行	淨零永續 2024 關鍵行動論壇	6
		113/09/20	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	113 年度防範內線交易宣導會	3
稽核主管	陳嘉洲	113/04/10	中華民國內部稽核協會	不可不知 IFRS S1/S2 對內部控制及內部稽核應考量之重點及影響	6
		113/08/13	中華民國內部稽核協會	銷售及收款循環以及法令規章遵循事項之內部稽核要領	6

(九) 內部控制制度執行狀況：

1.內部控制制度聲明書：請參閱第 92 頁。

2.委託會計師專業審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

1.113 年度股東常會之決議事項及執行情形：

(1) 案由：　承認 112 年度營業報告書及財務決算表冊。
決議：　照案通過。(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)
執行情形：　股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項。

(2) 案由：　承認 112 年度盈餘分配表。
決議：　照案通過。(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)
執行情形：　股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項(每股配發現金股利 0.20 元)。

(3) 案由：　討論修訂「背書保證作業程序」。
決議：　照案通過。(詳細決議內容請至公開資訊觀測站查詢)
執行情形：　股東會當日重大訊息公告為股東會重要決議事項並將修訂後規則揭露於公開資訊觀測站。

2.113 年度及截至年報刊印日止，董事會之重要決議：

會議名稱	日期	重要決議
董事會	113.01.31	1、113 年度營運計畫
董事會	113.02.22	1、112 年度內控聲明書 2、112 年度營業報告書及財務決算表冊 3、變更委任簽證會計師 4、評估簽證會計師之獨立性、適任性及委任 113 年度簽證會計師 5、修訂「背書保證作業程序」 6、修訂「董事會議事規則」 7、召開 113 年股東常會 8、捐贈「財團法人華科事業群慈善基金會」案
董事會	113.03.27	1、112 年度盈餘分配表
董事會	113.04.29	1、修訂「股務作業」內部控制制度 2、113 年第一季合併財務報表
董事會	113.08.01	1、113 年第二季合併財務報表 2、訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」 3、112 年度永續報告書
董事會	113.10.30	1、113 年第三季合併財務報表 2、資金貸與華東科技(蘇州)USD32M 3、資金貸與鑫豐 USD5M 及為其於 NTD1,215M 元等值外幣內提供背書保證 4、提報民國 114 年度稽核計劃 5、增訂「永續資訊之管理」內部控制制度及內部稽核實施細則 6、修訂「董事會議事規則」 7、修訂「審計委員會組織規程」
董事會	114.01.17	1、114 年度營運計畫 2、修訂「董事會議事規則」
董事會	114.02.20	1、113 年度內控聲明書 2、113 年度營業報告書及財務決算表冊 3、評估簽證會計師之獨立性、適任性及委任 114 年度簽證會計師 4、召開 114 年股東常會
董事會	114.03.27	1、113 年度盈餘分配表 2、修訂「取得或處分資產處理程序」 3、修訂「公司章程」 4、董事任期屆滿改選案 5、解除第十一屆新任董事競業禁止之限制案
董事會	114.04.29	1、修訂「股務作業」內部控制制度 2、114 年第一季合併財務報表

(十一) 最近年度及截至年報刊印日止，董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十二) 最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總：無。

三、簽證會計師公費資訊

新台幣：仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名		會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	許瑞軒	劉裕祥	113.01~113.12	6,980	1,396 (註)	8,376	無

註：服務內容主要為營所稅申報查核簽證、移轉訂價及轉投資申請等。

公司有下列情形之一者，應揭露下列事項：

(一) 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容：無。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

四、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	一一三年二月二十二日經董事會通過		
更換原因及說明	因簽證會計師事務所內部調動，本公司財務報表原由許瑞軒及江佳玲會計師簽證，自一一三年第一季起改為許瑞軒及劉裕祥會計師繼任之。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
			其他
	無		
	說明：不適用		
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無		

(二) 關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	劉裕祥
委任之日期	一一三年二月二十二日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三) 前任會計師對本準則第 10 條第 6 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函：不適用。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。

六、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形：

職稱	姓名	113 年度		當年度截至 5 月 20 日止	
		持有股數增（減）數	質押股數增（減）數	持有股數增（減）數	質押股數增（減）數
董事長	焦佑衡	0	0	0	0
董事 (並為大股東)	華新麗華(股)公司 代表人：焦佑倫	0	0	0	0
董事	華邦電子(股)公司 代表人：詹東義	0	0	0	0
董事	華新科技(股)公司 代表人：束耀先	0	0	0	0
董事 (兼任總經理)	于鴻祺	(690,000)	0	500,000	0
獨立董事	呂禮正	0	0	0	0
獨立董事	郝海晏	0	0	0	0
獨立董事	林旺財	0	0	0	0
獨立董事	邱靖雅	0	0	0	0
副總經理	高順隆	(108,000)	0	0	0
副總經理	張茂庭	(140,000)	0	0	0
協理 (兼任財會主管)	黃靖窈	(72,000)	0	0	0
協理	劉威吾	(20,000)	0	0	0
協理	林秀親	(10,000)	0	0	0
協理	李玉莉	(20,000)	0	0	0

(二) 股權移轉資訊：本公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉均在公開市場上為之。

(三) 股權質押資訊：無。

七、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二等親等以內之親屬關係之資料：

114 年 4 月 13 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
華新麗華(股)公司	109,628,376	21.17	0	0.00	0	0	焦佑倫 焦佑衡 焦佑鈞 華邦電子 信昌電陶 華新科技 瀚宇博德	董事長 董事長之二親等 董事長之二親等 華新麗華董事長與華邦電子董事長為二親等關係 華新麗華董事長與信昌電陶董事長為二親等關係 華新麗華董事長與華新科技董事長為二親等關係 華新麗華董事長與瀚宇博德董事長為二親等關係	無
華新麗華(股)公司 代表人：焦佑倫	4,874,448	0.94	1,218,611	0.24	0	0	焦佑衡 焦佑鈞 華邦電子 信昌電陶 華新科技 瀚宇博德	二親等 二親等 與華邦電子董事長為二親等關係 與信昌電陶董事長為二親等關係 與華新科技董事長為二親等關係 與瀚宇博德董事長為二親等關係	無
華邦電子(股)公司	50,062,641	9.67	0	0.00	0	0	焦佑鈞 焦佑倫 焦佑衡 華新麗華 信昌電陶 華新科技 瀚宇博德	董事長 董事長之二親等 董事長之二親等 華邦電子董事長與華新麗華董事長為二親等關係 華邦電子董事長與信昌電陶董事長為二親等關係 華邦電子董事長與華新科技董事長為二親等關係 華邦電子董事長與瀚宇博德董事長為二親等關係	無
華邦電子(股)公司 代表人：焦佑鈞	104,765	0.02	0	0.00	0	0	焦佑倫 焦佑衡 華新麗華 信昌電陶 華新科技 瀚宇博德	二親等 二親等 與華新麗華董事長為二親等關係 與信昌電陶董事長為二親等關係 與華新科技董事長為二親等關係 與瀚宇博德董事長為二親等關係	無
信昌電子陶瓷(股)公司	31,915,536	6.16	0	0.00	0	0	焦佑衡 焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 華新科技 瀚宇博德	董事長 董事長之二親等 董事長之二親等 信昌電陶董事長與華新麗華董事長為二親等關係 信昌電陶董事長與華邦電子董事長為二親等關係 信昌電陶與華新科技董事長為同一人 信昌電陶與瀚宇博德董事長為同一人	無

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
信昌電子陶瓷(股)公司 代表人：焦佑衡	10,208,592	1.97	463,071	0.09	0	0	焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 華新科技 瀚宇博德	二親等 二親等 與華新麗華董事長為二親等關係 與華邦電子董事長為二親等關係 信昌電陶與華新科技董事長為同一人 信昌電陶與瀚宇博德董事長為同一人	無
華新科技(股)公司	31,870,087	6.16	0	0.00	0	0	焦佑衡 焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 信昌電陶 瀚宇博德	董事長 董事長之二親等 董事長之二親等 華新科技董事長與華新麗華董事長為二親等關係 華新科技董事長與華邦電子董事長為二親等關係 華新科技與信昌電陶董事長為同一人 華新科技與瀚宇博德董事長為同一人	無
華新科技(股)公司 代表人：焦佑衡	10,208,592	1.97	463,071	0.09	0	0	焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 信昌電陶 瀚宇博德	二親等 二親等 與華新麗華董事長為二親等關係 與華邦電子董事長為二親等關係 華新科技與信昌電陶董事長為同一人 華新科技與瀚宇博德董事長為同一人	無
瀚宇博德(股)公司	14,761,000	2.85	0	0.00	0	0	焦佑衡 焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 信昌電陶 華新科技	董事長 董事長之二親等 董事長之二親等 瀚宇博德董事長與華新麗華董事長為二親等關係 瀚宇博德董事長與華邦電子董事長為二親等關係 瀚宇博德與信昌電陶董事長為同一人 瀚宇博德與華新科技董事長為同一人	無
瀚宇博德(股)公司 代表人：焦佑衡	10,208,592	1.97	463,071	0.09	0	0	焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 信昌電陶 華新科技	二親等 二親等 與華新麗華董事長為二親等關係 與華邦電子董事長為二親等關係 瀚宇博德與信昌電陶董事長為同一人 瀚宇博德與華新科技董事長為同一人	無

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
焦佑衡	10,208,592	1.97	463,071	0.09	0	0	焦佑倫 焦佑鈞 華新麗華 華邦電子 信昌電陶 華新科技 瀚宇博德	二親等 二親等 與華新麗華董事長為二親等關係 與華邦電子董事長為二親等關係 為該法人股東之董事長 為該法人股東之董事長 為該法人股東之董事長	無
焦佑倫	4,874,448	0.94	1,218,611	0.24	0	0	焦佑衡 焦佑鈞 華邦電子 信昌電陶 華新科技 瀚宇博德 華新麗華	二親等 二親等 與華邦電子董事長為二親等關係 與信昌電陶董事長為二親等關係 與華新科技董事長為二親等關係 與瀚宇博德董事長為二親等關係 為該法人股東之董事長	無
渣打國際商業銀行營業部受託保管箭道投資信託之子基金箭道全球股票ACWI信託基金投資專戶	3,604,000	0.70	0	0.00	0	0	無	無	無
李春份	2,561,000	0.49	0	0.00	0	0	無	無	無
梁蘭云	2,250,000	0.43	0	0.00	0	0	無	無	無

註：持股比例之計算係包含截至 114 年股東常會停止過戶日止本公司持有已買回股份尚未辦理轉讓或註銷股份 12,000,000 股。

八、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：

113 年 12 月 31 日

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Walton Holding Universal Ltd.	8,881	100%	0	0%	8,881	100%
紘通企業股份有限公司	6,443,654	10%	0	0%	6,443,654	10%
博德新能股份有限公司	750,000	15%	0	0%	750,000	15%
Walton Holding (Hong Kong) Ltd.	4,800,000	100%	0	0%	4,800,000	100%
精博信華實業(香港)有限公司	4,800,000	20%	0	0%	4,800,000	20%

註：係公司採用權益法之投資。

參、募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源：

1.股本形成經過：

114 年 4 月 13 日

年/月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數(股)	金額(元)	股數(股)	金額(元)	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
84.04	10	100,000,000	1,000,000,000	100,000,000	1,000,000,000	附註(1)	無	無
86.09	15	300,000,000	3,000,000,000	200,000,000	2,000,000,000	附註(2)	無	無
87.08	16	300,000,000	3,000,000,000	300,000,000	3,000,000,000	附註(3)	無	無
88.12	10	330,000,000	3,300,000,000	308,125,000	3,081,250,000	附註(4)	吸收宗大合併增資 81,250 仟元	無
90.09	10	380,000,000	3,800,000,000	342,537,500	3,425,375,000	附註(5)	90 年盈餘轉列增資 344,125 仟元	無
91.08	10	700,000,000	7,000,000,000	448,361,500	4,483,615,000	附註(6)	吸收華東先進合併增資 1,058,240 仟元	無
94.12	10	700,000,000	7,000,000,000	443,361,500	4,433,615,000	附註(7)	無	無
95.08	14	700,000,000	7,000,000,000	455,125,500	4,551,255,000	附註(8)	無	無
96.09	10	700,000,000	7,000,000,000	460,854,013	4,608,540,130	附註(9)	95 年盈餘轉列增資	無
97.09	10	700,000,000	7,000,000,000	501,898,713	5,018,987,130	附註(10)	96 年盈餘轉列增資	無
97.10	10	700,000,000	7,000,000,000	495,790,713	4,957,907,130	附註(11)	庫藏股減資	無
98.08	10	700,000,000	7,000,000,000	490,790,713	4,907,907,130	附註(12)	庫藏股減資	無
99.03	10	700,000,000	7,000,000,000	491,881,713	4,918,817,130	附註(13)	員工認股權憑證轉換	無
99.09	10	700,000,000	7,000,000,000	501,920,030	5,019,200,300	附註(14)	98 年盈餘轉列增資員工認股權憑證轉換	無
100.01	10	700,000,000	7,000,000,000	502,095,030	5,020,095,030	附註(15)	員工認股權憑證轉換	無
100.04	10	700,000,000	7,000,000,000	502,562,030	5,025,620,300	附註(16)	員工認股權憑證轉換	無
100.07	10	700,000,000	7,000,000,000	502,572,030	5,025,720,300	附註(17)	員工認股權憑證轉換	無
101.04	10	700,000,000	7,000,000,000	502,668,030	5,026,680,300	附註(18)	員工認股權憑證轉換	無
102.07	10	700,000,000	7,000,000,000	500,668,030	5,006,680,300	附註(19)	庫藏股減資	無
104.11	10	700,000,000	7,000,000,000	482,963,030	4,829,630,300	附註(20)	庫藏股減資	無
105.06	10	700,000,000	7,000,000,000	482,770,030	4,827,700,300	附註(21)	庫藏股減資	無
106.07	10	700,000,000	7,000,000,000	482,855,744	4,828,557,440	附註(22)	可轉換公司債轉換為普通股 85,714 股	無
106.11	10	700,000,000	7,000,000,000	490,242,574	4,902,425,740	附註(22)	可轉換公司債轉換為普通股 7,386,830 股	無
106.12	10	700,000,000	7,000,000,000	526,381,144	5,263,811,440	附註(22)	可轉換公司債轉換為普通股 36,138,570 股	無
108.03	10	700,000,000	7,000,000,000	506,381,144	5,063,811,440	附註(23)	庫藏股減資	無
110.04	10	700,000,000	7,000,000,000	521,721,876	5,217,218,760	附註(24)	可轉換公司債轉換為普通股 15,340,732 股	無
111.12	10	700,000,000	7,000,000,000	517,739,876	5,177,398,760	附註(25)	庫藏股減資	無

註:(1) 84 年 4 月創立時股本為新台幣壹拾億元整。

(2) 86 年現金增資 1,000,000 仟元係經財政部證券暨期貨管理委員會 86 年 7 月 8 日(86)台財證(一)第五二三六一號函核准在案。

(3) 87 年現金增資 1,000,000 仟元係經財政部證券暨期貨管理委員會 87 年 7 月 16 日(87)台財證(一)第五九九七一號函核准在案。

(4) 88 年合併增資係經財政部證券暨期貨管理委員會 88 年 11 月 24 日(88)台財證(一)第一〇一二五九號函核准在案。

(5) 90 年盈餘轉增資係經財政部證券暨期貨管理委員會 90 年 9 月 29 日(90)台財證(一)第一五四四五九號函核准在案。

(6) 91 年合併增資係經財政部證券暨期貨管理委員會 91 年 7 月 3 日(91)台財證(一)第〇九一〇一三六一九三號函核准在案。

(7) 94 年減資係經行政院金融監督管理委員會 94 年 12 月 16 日金管證一字第 0940157388 號函核准在案。

(8) 95 年現金增資 117,640 仟元係經行政院金融監督管理委員會 95 年 7 月 27 日金管證一字第 0950133075 號函核准在案。

(9) 96 年盈餘轉增資係經行政院金融監督管理委員會 96 年 8 月 2 日金管證一字第 0960040793 號函核准在案。

(10) 97 年盈餘轉增資係經行政院金融監督管理委員會 97 年 7 月 17 日金管證一字第 0970036044 號函核准在案。

(11)97 年減資係經行政院金融監督管理委員會 97 年 10 月 2 日金管證三字第 0970051202 號函及 97 年 11 月 28 日金管證三字第 0970065499 號函核准在案。

(12)98 年減資係經行政院金融監督管理委員會 98 年 5 月 1 日金管證三字第 0980019406 號函。

(13) 98 年員工認股權轉換係經行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 24 日金管證三字第 0960071859 號函。

(14)99 年員工認股權轉換係經行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 24 日金管證三字第 0960071859 號函。
98 年盈餘轉增資係經行政院金融監督管理委員會 99 年 7 月 29 日金管證發字第 0990039649 號函核准在案。
(15) 100 年員工認股權轉換係經行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 24 日金管證三字第 0960071859 號函。
(16) 100 年員工認股權轉換係經行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 24 日金管證三字第 0960071859 號函。
(17) 100 年員工認股權轉換係經行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 24 日金管證三字第 0960071859 號函。
(18) 100 年員工認股權轉換係經行政院金融監督管理委員會 96 年 12 月 24 日金管證三字第 0960071859 號函。
(19) 102 年減資係經行政院金融監督管理委員會 99 年 5 月 10 日金管證三字第 0990024111 號函。
(20) 104 年減資係經行政院金融監督管理委員會 104 年 10 月 5 日金管證交字第 1040040612 號函。
(21) 105 年減資係經行政院金融監督管理委員會 102 年 5 月 28 日金管證交字第 1020021812 號函。
(22) 106 年轉換公司債轉換係經行政院金融監督管理委員會 103 年 10 月 27 日金管證發字第 10300413411 號函。
(23) 108 年減資係經行政院金融監督管理委員會 109 年 1 月 3 日金管證交字第 1080342301 號函。
(24) 110 年轉換公司債轉換係經行政院金融監督管理委員會 107 年 1 月 15 日金管證發字第 1060050949 號函。
(25) 111 年減資係經行政院金融監督管理委員會 108 年 2 月 14 日金管證交字第 1080303974 號函。

2.股份種類：

單位：股；114年4月13日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	517,739,876	182,260,124	700,000,000	上市

註：流通在外股份包含本公司已買回股份尚未辦理轉讓或註銷股份 12,000,000 股。

3.經核准以總括申報制度募集發行有價證券：無。

(二) 主要股東名單：

1.持股比例達百分之五以上之股東名稱、持股數額及比例：

114 年 4 月 13 日

股份 主要股東名稱	持有股數	持股比例
華新麗華股份有限公司	109,628,376	21.17
華邦電子股份有限公司	50,062,641	9.67
信昌電子陶瓷股份有限公司	31,915,536	6.16
華新科技股份有限公司	31,870,087	6.16

註：持股比例之計算係包含截至 114 年股東常會停止過戶日止，本公司持有已買回股份尚未辦理轉讓或註銷股份 12,000,000 股。

2.持股比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例之相關資料請參閱第 48~50 頁。

(三) 公司股利政策及執行狀況：

1.股利政策

本公司在營業上所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境，以求永續經營及長遠發展，董事會擬定盈餘分配案時，將著重股利之穩定性與成長性，每年度分配可分配盈餘時，原則上不高於百分之九十，其中現金股利部分不低於股東紅利之百分之十。

2.本次股東會擬議股利分配之情形：本公司擬自 113 年度盈餘配發股東現金股利新台幣 101,147,976 元，每股發放現金股利 0.20 元，實際分配情形將待股東會決議後執行之。

(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。

(五) 員工、董事酬勞：

1.公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之十為員工酬勞，發放對象得包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件授權董事長決定之；另提撥不超過百

分之二為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

2.本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：

本公司董事會擬議113年度員工酬勞及董事酬勞金額分別為新台幣7,742,622元及新台幣3,011,019元，分別佔獲利金額3.60%及1.40%，與113年度估計之帳列員工酬勞及董事酬勞無差異。

3.董事會通過分派酬勞情形：

(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形：

民國 113 年度員工及董事酬勞以現金方式分派，分派數分別為新台幣7,742,622元及新台幣3,011,019元，與113年帳列估計金額無差異。

(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4.前一年度員工分紅及董事酬勞之實際分派情形：

本公司112年度決算無獲利，故無分派員工及董事酬勞。

(六) 公司買回本公司股份情形：

114年5月20日

買回期次	十四
買回目的	轉讓股份予員工
買回期間	113.3.28~113.5.27
買回區間價格	15.5 ~ 19.5 元
已買回股份種類	普通股
已買回股份數量	10,000,000 股
已買回股份金額	182,197,931 元
已買回數量占預定買回數量之比率(%)	100 %
已辦理銷除及轉讓之股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量	12,000,000 股
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	2.32 %

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍：

1.所營業務主要內容：

(1)電子零組件製造業。

(2)電子材料批發業。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元

項目	113 年度營收淨額	營業比重(%)
封裝	4,987,752	63
測試	2,871,704	37
合計	7,859,456	100

3.目前之主要產品：

(1) 無接腳扁平封裝(QFN/SON)。
(2) 短形化小型封裝(SOP)。
(3) 高腳數超薄小型晶粒承載器積體電路(TSOP)。
(4) 球型陣格承載器積體電路(BGA)。
(5) 晶片堆疊封裝(Multi-Chip Stacking Package, MCP)。
(6) 晶片尺寸記憶體封裝(CSP and Trench BGA)。
(7) 雙晶片封裝(Dual Dies Package)。
(8) 四晶片封裝(Four dies Package)。
(9) 八晶片封裝(8 Dies Package)。
(10) Package on Package 封裝(POP)。
(11) Package in Package 封裝(PIP)。
(12)熱金屬氧化半導體(TMOS-Thermal Metal Oxide Semiconductor)。
(13)暫存記憶體(Flash DFN)。
(14)功率管理 IC(Power SIP)。

4.計劃開發之產品：

(1) 晶圓級封裝(Wafer Level Assy)。
(2) System in Package 封裝(SIP)。
(3) 16 die stacking of Memory Package。
(4) FlipChip for Memory Package。
(5) FlipChip for Logic Package。
(6) Mini LED Package。
(7) Leadframe-based System in Package。
(8) Flip Chip for System In Package。
(9) System in Package for Power module。
(10) RDL+Bumping for WLCSP。
(11) Flip chip + Wire bonding for hybrid package。
(12) Flip chip stacking DRAM。
(13) Flip chip for NOR Flash。

(14) Fan Out Wafer Level Package (FOWLP)。
(15) RF Coupler。
(16) Passive Components Coating。

(二)產業概況：

1.產業現況及發展：

2024 年全球經濟呈現溫和復甦的態勢，全球通膨壓力緩解，但仍受地緣政治、通膨與貨幣政策影響。美國經濟穩健成長，歐洲需求疲軟，中國則透過政策刺激維持增長。市場正從 2023 年的低谷逐步回升，主要受惠於全球需求的復甦、人工智慧（AI）技術的蓬勃發展以及供應鏈庫存調整的結束。

然而，美中科技戰與各國半導體政策影響全球供應鏈，美國《晶片法案》、歐盟《歐洲晶片法案》推動在地製造，導致供應鏈分散化。此外，高利率環境與通膨壓力仍對消費電子市場構成挑戰，智慧型手機、PC 需求雖回溫，但增長仍較緩慢。整體而言，2024 年全球經濟復甦支撐半導體市場成長，地緣政治風險、貿易保護主義、供應鏈變化以及氣候變遷等結構性挑戰仍為經濟發展帶來不確定性。

以全球區域半導體市場來看，美國、中國大陸與亞太三大區域市場為領先族群。其中，美國市場銷售額達 1,946 億美元，年增 44.8%，展現強勁成長動能。中國大陸市場銷售額為 1,825 億美元，較 2023 年成長 18.3%。亞太地區（不含中國）市場銷售額達 1,527 億美元，年增 12.5%。相較之下，日本市場銷售額為 466 億美元，年減 0.4%，歐洲市場銷售額則為 513 億美元，年減 8.1%。各主要市場表現有所分化，以美國與中國市場成長最為顯著。然而，綜觀全球半導體市場將維持穩健成長，主要受惠於技術創新、人工智慧（AI）應用擴展及市場需求提升。

整體而言，2024 年全球半導體市場呈現穩健成長態勢，整體銷售值、總銷貨量及平均銷售單價（ASP）均較 2023 年有所提升。全年總銷售值達 6,276 億美元，較 2023 年成長 19.1%，顯示市場需求回溫。總銷售量方面，2024 年全球半導體出貨量達 9,525 億顆，較 2023 年成長 3.42%，顯示市場需求穩定復甦，整體出貨量呈現正向成長。值得注意的是，2024 年半導體平均銷售單價（ASP）達 0.659 美元，較 2023 年成長 14.32%，，平均售價創下七年來歷史新高。顯示出高價值產品占比提升，特別是在 AI 晶片、高頻寬記憶體（HBM）、先進製程晶片等領域需求增長，使產品附加價值提高，進而推升整體 ASP 上揚。這反映了市場對高階半導體產品的需求增加，並帶動整體產業價值的提升。隨著人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、車用電子及物聯網（IoT）等應用持續推動市場需求，半導體產業仍將維持成長態勢。特別是 AI 技術的快速發展，帶動先進製程晶片、高頻寬記憶體（HBM）及特殊應用晶片（ASIC）的需求增加，進一步推升整體市場規模。此外，消費性電子復甦、5G 與 Wi-Fi 7 的普及，以及各國對半導體供應鏈自主化的推動，也將持續影響市場格局。

一向是全球半導體產業資優生的台灣半導體產業，受惠於 AI、HPC、5G 與車用電子需求回升，再加上高階智慧型手機與 AI PC 等新品上市帶動下，相關晶片需求成長，更進一步推升先進製程與封裝業務，強力帶動整體產業成長，因此臺灣 IC 產業繼 2021 年突破新台幣 4 兆元的里程碑後，雖歷經全球政治經濟不穩定的態勢下，在 2024 年總產值突破 5 兆美元大關。

根據工研院產科國際所統計(見表一)，2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元，較 2023 年增長 22.4%，顯示台灣半導體產業強勁的復甦動能，遠高於全球半導體產業平均增速，鞏固台灣在全球半導體供應鏈的關鍵地位。IC 製

造業產值達新臺幣 34,195 億元，年成長 28.4%，為四大產業中成長最為顯著的領域。其中，晶圓代工 2024 年產值達新臺幣 32,438 億元，較 2023 年大幅成長 30.1%；而記憶體與其他製造產值為新臺幣 1,757 億元，年增 3.3%，成長相對溫和，然展現了台灣記憶體產業的抗壓性。IC 設計業 2024 年產值達新臺幣 12,721 億元，年增 16.0%。IC 封裝業產值達新臺幣 4,233 億元(約 13.2 億美元)，年增 7.7%，由於先進封裝技術如系統級封裝(SiP)、2.5D/3D 封裝等需求增加，為封裝業者帶來新成長動能，再加上 AI 晶片對於封裝散熱要求提高，亦帶動高階封裝技術開發。IC 測試業產值為新臺幣 2,002 億元(約 6.2 億美元)，年增 5.0%，高階製程晶片測試複雜度增加，推動測試技術升級及新增設備投資。特殊應用晶片如 AI 加速器、車用晶片等對測試可靠性要求提升，有利於測試業者提高附加價值。(新臺幣對美元匯率以 32.1 計算。)

表一 2024 年台灣 IC 產業產值統計結果

單位：億新台幣

	24Q1	24Q1 年成長	24Q2	24Q2 年成長	24Q3	24Q3 年成長	24Q4	24Q4 年成長	2024	2024 年成長
IC 產業產值	11,667	15.7%	12,702	25.1%	13,840	24.0%	14,942	24.2%	53,151	22.4%
IC 設計業	3,002	25.1%	3,125	16.4%	3,256	13.1%	3,338	11.3%	12,721	16.0%
IC 製造業	7,193	14.6%	8,071	32.9%	8,965	32.7%	9,966	32.6%	34,195	28.4%
晶圓代工	6,749	14.9%	7,605	34.7%	8,508	34.7%	9,576	35.1%	32,438	30.1%
記憶體與其他製造	444	9.4%	466	8.9%	457	3.9%	390	-8.7%	1,757	3.3%
IC 封裝業	987	5.0%	1,022	10.2%	1,114	7.6%	1,110	7.9%	4,233	7.7%
IC 測試業	485	4.3%	484	4.5%	505	3.1%	528	8.2%	2,002	5.0%
IC 產品產值	3,446	22.8%	3,591	15.4%	3,713	11.8%	3,728	8.8%	14,478	14.3%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	6,276	19.1%

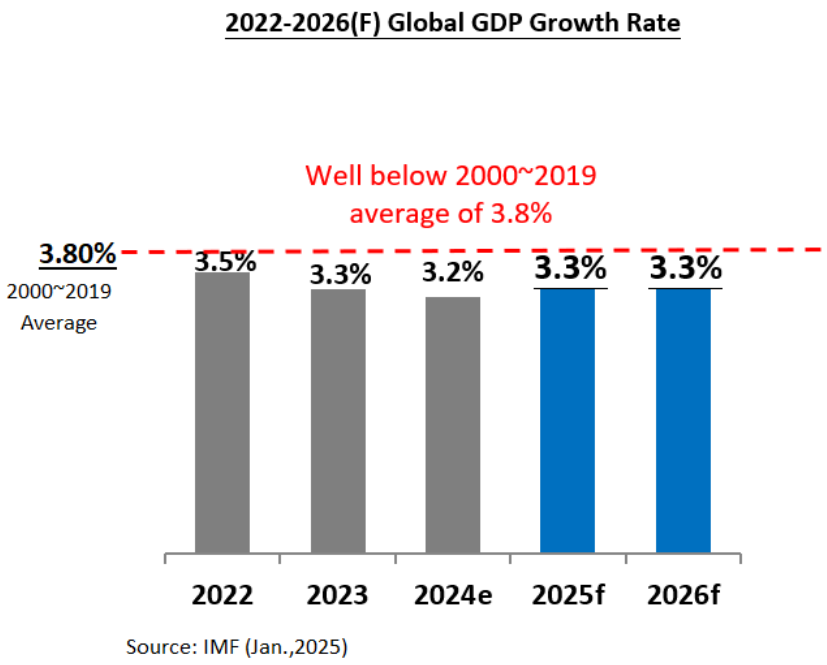
資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

說明：

- 註：(e)表示預估值(estimate)。
- IC 產業產值=IC 設計業+IC 製造業+IC 封裝業+IC 測試業。
- IC 產品產值=IC 設計業+記憶體與其他製造。
- IC 製造業產值=晶圓代工+記憶體與其他製造。
- 2017 年起華亞科(為美光子公司)已不列入上述台灣記憶體與其他製造產值計算。
- 上述產值計算是以總部設立在台灣的公司為基準。

2024 年國際貿易格局持續受到地緣政治因素影響，貿易保護主義加劇。美中貿易壁壘分明，美國對中國的半導體及先進技術出口管制範圍進一步擴大，中國則強化國產替代戰略。此外，美國已經針對電動車、太陽能面板和一些關鍵礦產實施新的關稅政策，中國則通過出口管制和市場准入限制作為回應。然而，全球供應鏈持續進行「友岸外包」(friend-shoring)和多元化布局，企業加速建立更具韌性的供應鏈網絡，尤其在半導體、關鍵礦產等戰略產業。這種供應鏈重組雖在短期內增加了成本壓力，但長遠來看將提高全球供應體系的穩定性。

根據國際貨幣基金組織(IMF)最新預測，2025 年全球經濟成長率預計為 3.3%，較 2024 年略有提升。主要是因為美國經濟成長預測上調，剛好抵銷了其他主要經濟體的下修影響。全球通膨率則預計在 2025 年降至 4.2%，並在 2026 年進一步回降至 3.5%。此將有助於各國的貨幣政策走向正常化以及全球貿易活動穩定成長，使得全球經濟在這兩年內能保持穩定成長。



圖一 2022-205(F)全球 GDP 趨勢圖

資料來源：IMF(2025/01)&華東科技行銷業務部整理

半導體產業是一個具有明顯週期性的產業，其趨勢與波動深受全球經濟、技術創新及市場需求等因素影響。2021 年~2022 年受惠於疫情帶動的遠距工作、線上學習及數位娛樂需求，半導體市場進入超級週期，需求大幅成長，造成全球供應鏈緊張，晶片短缺現象。進入 2023 年後，全球經濟放緩、通膨壓力及消費性電子產品需求下滑，導致半導體市場進入庫存調整期；所幸，人工智慧（AI）相關應用需求開始浮現，為產業帶來新的成長動能。2024 年庫存去化接近尾聲，半導體市場呈現全面復甦，需求逐步回升。AI 晶片成為產業增長的主要驅動力，推動高效能運算、高頻寬記憶體等相關產品需求激增。根據 WSTS 預估(2024 年 12 月)，2025 年全球半導體產業將成長 11.2%，產值達 6,979 億美元。整體而言，半導體產業正從 2021-2024 年的波動調整期邁向更加多元、韌性和創新驅動的新階段，而 2025 年無疑是這一轉型過程中關鍵的一年。

從產業資本支出的角度來看，受到終端需求變化、通膨及地緣政治等因素影響，全球對晶片日益增長的需求，特別是在先進製程和生成式 AI 等領域。根據 SEMI (國際半導體產業協會) 2025 年 1 月公布的最新一季全球晶圓廠預測報告(World Fab Forecast)預計 2025 年將增速成長 6.6%，達每月 3,360 萬片大關。SEMI 表示：「半導體產業正處於關鍵時刻，擴產投資正在推進先進與主流技術的發展，以滿足不斷演進的全球產業需求。生成式 AI 與高效能運算，正在推動先進邏輯與記憶體領域的進步，而主流製程則繼續支撐汽車、物聯網和功率電子類別等關鍵應用。」總體而言，半導體產業在未來幾年將持續進行大規模的資本支出，以擴大產能並推動技術創新，以滿足全球對晶片日益增長的需求。

展望未來，中美關係持續緊張的態勢以及地緣政治關係依然是全球產業生態的主軸，擁有全球最完整產業供應鏈的台灣，在全球半導體產業中具有舉足輕重之地位。

工研院產科國際所(2025 年 2 月)統計數值顯示，2023 年全球半導體產業受到全球消費電子需求疲軟及客戶庫存調整影響，導致較前年下滑 10.2%。進入 2024 年後，呈現逐季改善的趨勢，顯示產業復甦動能持續加強。2024 年 IC 產業總產

值達新台幣 53,151 億元，年增率高達 22.4%。整體而言，台灣 IC 產業在 2021-2025 年間展現強大的韌性與技術創新能力，從 2021 年的高速成長到 2023 年的調整，再到 2024-2025 年的強勁復甦，台灣 IC 產業不僅成功應對了全球供應鏈重組的挑戰，還通過技術升級與產品結構優化，持續強化其在全球半導體產業中的核心地位。

進入 2025 年，台灣半導體產業協會(TSIA)預期台灣 IC 產值將成長 16.2%，略低於全球半導體產業的成長率 19.1%，可望突破新台幣 6 兆大關。其中，台灣 IC 封裝產值預估年成長 8.9%，達新台幣 4,608 億元，而 IC 測試產值預計漲幅 9.6%，達新台幣 2,195 億元。AI 相關應用將持續成為台灣 IC 產業的主要成長動力，而地緣政治因素及供應鏈安全考量也將為台灣 IC 產業帶來新的機遇與挑戰。在技術創新、產能擴充及國際合作等方面的持續投入，將是台灣 IC 產業保持全球競爭力的關鍵。

表二 2021 年~2025 年台灣 IC 產業產值

單位：億新台幣

億新臺幣	2021	2021 成長率	2022	2022 成長率	2023	2023 成長率	2024	2024 成長率	2024(e)	2025(e) 成長率
IC 產業產值	40,820	26.7%	48,370	18.5%	43,428	-10.2%	53,151	22.4%	61,785	16.2%
IC 設計業	12,147	42.4%	12,320	1.4%	10,965	-11.0%	12,721	16.0%	14,155	11.3%
IC 製造業	22,289	22.4%	29,203	31.0%	26,626	-8.8%	34,195	28.4%	40,827	19.4%
晶圓代工	19,410	19.1%	26,847	38.3%	24,925	-7.2%	32,438	30.1%	38,960	20.1%
記憶體與其他製造	2,879	51.0%	2,356	-18.2%	1,701	-27.8%	1,757	3.3%	1,867	6.3%
IC 封裝業	4,354	15.3%	4,660	7.0%	3,931	-15.6%	4,233	7.7%	4,608	8.9%
IC 測試業	2,030	18.4%	2,187	7.7%	1,906	-12.8%	2,002	5.0%	2,195	9.6%
IC 產品產值	15,026	44.0%	14,676	-2.3%	12,666	-10.2%	14,478	14.3%	16,022	10.7%
全球半導體市場(億美元)及成長率(%)	5,559	26.2%	5,741	3.3%	5,269	-8.2%	6,276	19.1%	6,979	11.2%

資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

● 註：(e)表示預估值(estimate)。

2.產業上、中、下游之關聯性：

隨著半導體製程技術的演進，技術研發的挑戰性日益提高，設備投資成本大幅攀升，營運管理的複雜度亦隨之提升，這已成為產業價值鏈上所有成員共同面臨的重大課題。因此，具備完整垂直整合能力並能獨立運作的整合元件製造廠（IDM, Integrated Device Manufacturer）數量逐漸減少。在此產業演進趨勢下，半導體產業的專業分工體系已趨於成熟（如下圖二所示），而台灣業者在晶圓製造與 IC 封裝測試領域更是全球領導者。

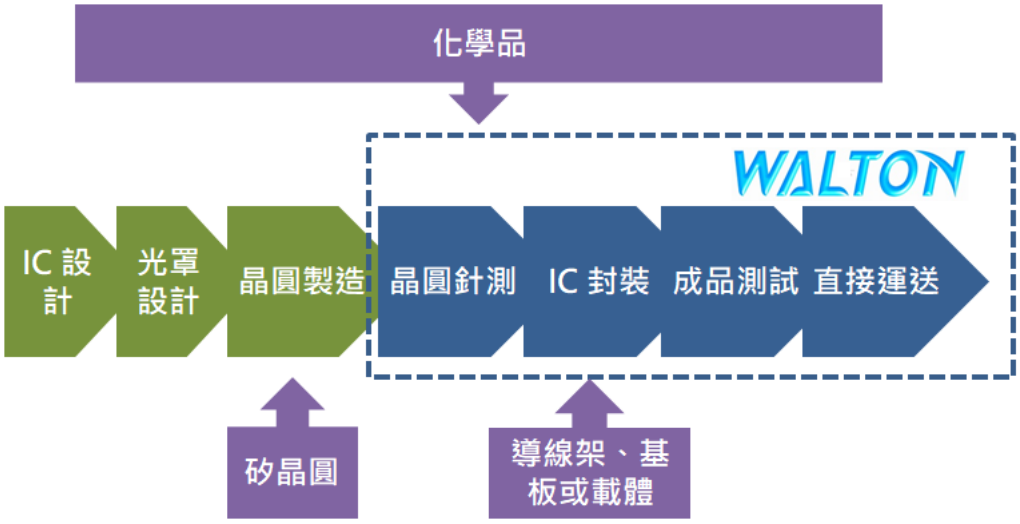
華東科技在整個半導體產業鏈中，位於 IC 設計、光罩設計與晶圓製造（Foundry）之後，服務範圍涵蓋 IC 封裝、成品測試及模組製造，屬於產業價值鏈的下游環節（如下圖二虛線框內所示）。晶圓（Wafer）的所有者，包括整合元件製造廠與 IC 設計公司，將其晶圓委託本公司進行封裝與成品測試，或製作為最終產品（如記憶體模組或記憶卡）後，再回貨給客戶。因此，對華東科技而言，客戶的晶圓產出量（Wafer Outputs）與每片晶圓上的顆粒數（Dies per Wafer）為 IC 封測業務量的重要指標。

從技術發展的角度來看，半導體產業除了要應對終端電子產品的快速演進，滿足更豐富的功能、更高效的運算能力，以及更輕薄化的設計需求；同時，針對雲端高效能運算應用，須推動新的架構方案以突破「記憶體牆」的限制，進而提

升運算效能以支援人工智慧（AI）應用。因此，「計算與記憶體的整合」已成為全球半導體產業供應鏈上所有業者的共同目標。不論是效能、功耗與外形設計各層面，均需從整體系統角度進行考量，更推動了系統級晶片封裝（System in Package, SiP）以及 2.5D/3D 封裝技術的發展，使得這些技術成為半導體產業關注的焦點。

華東科技在半導體產業鏈中擔任橋樑的角色，連結上游晶圓製造與下游終端應用，憑藉在記憶體封裝測試領域的專業技術，串聯半導體產業上游的設計製造，以及下游應用市場，為記憶體產品從晶圓到終端應用的轉換過程提供關鍵技術支持。展望未來，隨著系統級封裝技術持續創新與普及，IC 封裝與測試在整個半導體產業中將擔負更為關鍵的責任。華東科技亦將持續深耕技術研發，強化競爭優勢，為全球半導體產業發展貢獻力量。

圖二 半導體產業價值鏈



資料來源：華東科技行銷業務部整理

3.產品之各種發展趨勢：

從技術發展的角度而言，IC 封裝不僅為 IC 提供必要的保護與隔離，更是連結 IC 與系統產品的關鍵。不同的 IC 封裝形式決定了個別 IC 與其他 IC、電子元件及電路板的連結方式與密度，進而影響 IC 的效能與電性表現、散熱特性、電路板佔用面積與高度，以及日益受到重視的功耗表現與能源效率。

IC 封裝技術的分類主要依據其所使用的乘載材料。在記憶體 IC 領域，早期封裝主要採用導線架（Leadframe）作為晶片乘載材料，封裝型態包括 SOP（Small-Outline Package）、SOJ（Small Outline J-lead）及 TSOP（Thin Small Outline Package）。然而，隨著電子產品朝向高效能與小型化發展，傳統封裝方式已無法滿足高密度 I/O 需求，因此 BGA（Ball Grid Array）封裝技術應運而生。BGA 封裝採用基板（Substrate）作為記憶體 IC 的主要乘載材料，不僅可實現更緊湊的封裝體積，亦大幅提升導熱性能。

從產品應用需求角度來看，封裝作為連接 IC 與系統產品的關鍵技術，隨電子系統產品的發展趨勢與需求同步演進，以滿足效能提升、省電需求及尺寸優化等多方面要求。當前電子產品市場中，智慧型手機仍為唯一年出貨量突破十億台的品類，行動裝置已成為市場主流。在省電與輕薄化的雙重驅動下，全球 DRAM 業者逐步將產能轉向 LPDRAM（Low Power DRAM），導致標準型 PC DRAM 與

LPDRAM 市場份額此消彼長。

就產品應用需求面來看，封裝技術既是 IC 與系統產品之間最重要的連結，自是隨著電子系統產品的發展趨勢與需求而演進，以滿足電子系統產品在效能、省電性與體積等各種層面上的要求。放眼現今電子產品市場，智慧型手機仍是唯一年出貨量破十億門檻的電子產品,「行動」早已是終端產品中不言自明的主流。在省電性與輕薄體積的兩大重要訴求驅使下，全球 DRAM 業者持續將產能轉換至 LP DRAM(Low Power DRAM)，影響所及，PC 用的標準型 DRAM 與智慧型手機用的 LP DRAM 兩者的市場份額自是互有消長。

目前，智慧聯網裝置的設計通常以 NAND Flash 負責數據儲存，而 LPDRAM 專司資料處理，兩者皆為影響系統效能的關鍵組件。LPDRAM 強調低功耗與體積輕薄特性，雖與 PC DRAM 同採 BGA 封裝，然其應用方式有所不同。現行行動記憶體的主要封裝組合方式有二，分別說明如下：

(1) LP DRAM 與 NAND Flash 各自獨立封裝(Discrete)

i. LPDRAM 依據所需容量，採單顆或多顆 IC 封裝，並以 PoP（Package on Package，堆疊式封裝層疊）形式應用於智慧型手機或平板電腦，將封裝好的 LPDRAM 堆疊在應用處理器之上。PoP 技術可節省 PCB 空間，，還能增加應用處理器與記憶體之間的連結，縮短信號延遲以加速資料存取，進而提升整體系統的效能。因此，PoP 一直是高階行動裝置上記憶體封裝的主流作法。在超輕薄筆記型電腦（Ultrabook）與二合一筆記型電腦（2-in-1）中，LPDRAM 通常以直接焊接（Solder Down）方式固定於 PCB。

ii. 在 NAND Flash 的部分，其應用方式與 DRAM 有些不同，通常必須仰賴額外的管理介面，以降低 NAND Flash 供應商或製程變化對於系統設計造成的複雜度，這個管理介面也就是俗稱的控制 IC。因此，NAND Flash 封裝不僅要決定容量大小的配置，通常還需要增添一顆控制 IC，合併在單一封裝中。目前，可支援更快速存取的 UFS（Universal Flash Storage）介面已取代原先的 eMMC 成為市場主流。

(2) LP DRAM 與 NAND Flash 整合封裝（MCP，Multi-Chip Package）

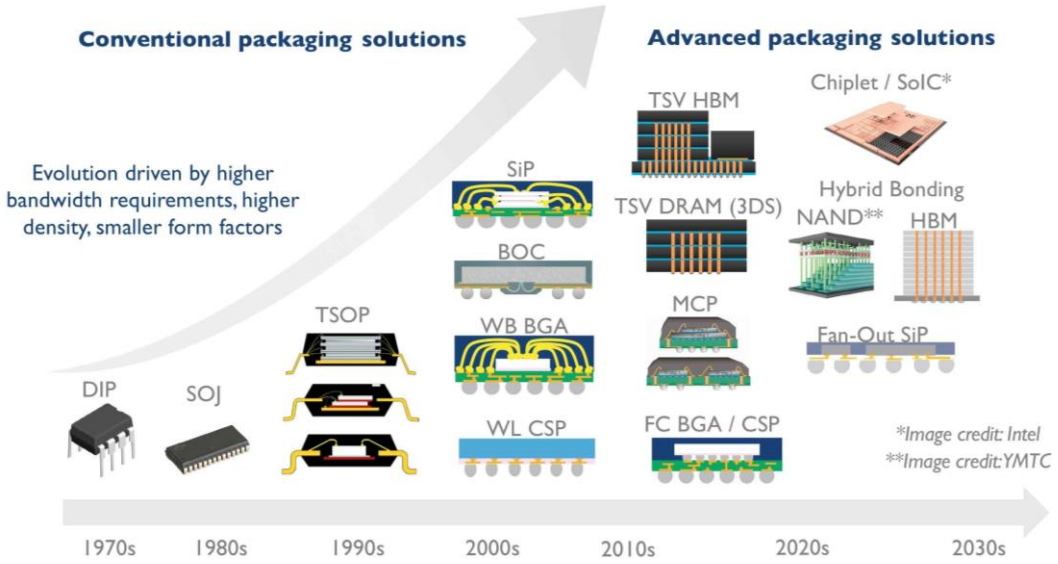
MCP 技術透過在單一封裝內堆疊多顆 LPDRAM 與 NAND Flash IC，實現系統運行與儲存功能的整合，進一步簡化 PCB 系統佈局並優化供應鏈管理。最初，MCP 技術以 eMMC 控制介面為基礎，稱為 eMCP，自 2012 年聯發科行動應用處理器開始支援後，迅速滲透至中低階智慧型手機市場。隨著 AI、4K 視頻錄製及 5G 技術的發展，eMCP 逐漸難以滿足高效能需求，因此 LPDDR5 與 UFS 3.1 已成為旗艦手機的標準記憶體配置。同時，結合 UFS 介面的 uMCP 亦開始進入中端 5G 智慧型手機市場，未來預期其滲透率將持續提升，以滿足日益增長的高速存取與低功耗需求。

在 IC 封裝技術發展方面，無論是獨立封裝或多晶片封裝（MCP），皆屬於多晶片封裝技術，主要區別在於 IC 內容的不同。封裝技術的核心競爭力取決於業者在晶圓研磨（Wafer Grind）、晶片切割（Die Saw）、黏晶（Die Bond）、銲線（Wire Bond）與封膠（Molding）等製程上的製程調校與品質管控能力。

而在 AI 應用大行其道後，NVIDIA 高階 GPU 已成為 AI 運算系統的顯學，對應的記憶體也從 PC DRAM, Graphic DRAM，進展到 HBM(High Bandwidth Memory)。HBM 是一種高性能記憶體技術，是透過堆疊記憶體晶片的配置來實現更高的頻寬和更低的功耗。有別於現行的架構，HBM 的 DRAM 不再是透過打線接合(Wire Bond)的方式進行堆疊，而是藉由 TSV(Through Silicon Via)技術，在

每一個矽晶圓上以蝕刻或雷射方式鑽孔(via)，使其能通過每一層晶片，再以導電材料如銅、多晶矽、鎢等物質填滿，而形成通道(即內部接合線路)來做連接的功能，最後則將晶圓或晶粒薄化再加以堆疊、結合(Bonding)，作為晶片間傳輸電訊號用之堆疊技術。

目前，HBM 規格已進展至 HBM3E，提供更高頻寬與容量，成為高效能計算與 AI 應用的核心記憶體技術。由於 TSV 製程與晶圓製造流程高度相似，因此 HBM 通常由記憶體供應商自行生產，以確保技術整合與生產效率的最佳化。展望未來，隨著 AI、高效能計算（HPC）及 5G 應用的持續擴展，HBM 技術將在全球半導體產業中扮演愈發關鍵的角色。



圖三 記憶體 IC 封裝技術演進

資料來源：Yole Development, 2021

IC 測試方面，關鍵在於根據記憶體 IC 的類型與規格（涵蓋速度、電性等）提供高效且具成本效益的測試解決方案。隨著近年來行動應用處理器之性能的迅速提升，對應的系統記憶體標準亦同步快速演進，以滿足高速運算與低功耗需求。

為確保記憶體 IC 在實際應用中的穩定性與效能，測試技術須涵蓋多項關鍵製程，包括功能驗證、參數測試、溫度與壓力測試等，以全面評估其讀寫速率、訊號完整性及耐受度，確保產品在各種運作環境下皆能維持高可靠性與最佳性能表現。

隨著記憶體技術持續演進，LPDDR5、HBM 等高頻寬、低功耗記憶體已成為市場主流，其高速運作特性對測試技術提出更高要求。為因應此趨勢，測試設備須具備更嚴苛的頻率更延遲要求，以確保記憶體 IC 符合嚴格的市場規範與終端應用需求。此外，為提升測試效率並降低成本，現代測試技術正朝向自動化、高並行度與智能分析發展，透過 AI 輔助檢測，即時分析測試數據，優化參數調整，並預測潛在瑕疵，以提升生產良率與整體競爭力。隨著 5G、AI 及高效能運算（HPC）應用的快速發展，記憶體 IC 測試技術的精準度與效率將持續成為產業發展的關鍵驅動力。

因應記憶體 IC 技術的不斷演進，記憶體封測業者面臨更高的技術門檻與設備投資需求，以應對市場對高效能、低功耗與輕薄化產品的持續推動。在此背景下，封測技術的發展已成為提升記憶體產品競爭力的關鍵，涵蓋高密度封裝技術、

先進散熱設計與高精度測試方案等領域。

為順應全球電子產業的發展趨勢，華東科技與客戶持續保持緊密合作，積極研發更高效、更輕薄且具成本效益的記憶體封測解決方案，以滿足市場對新一代記憶體產品的需求。面對全球 DRAM 市場持續成長的趨勢，華東科技將憑藉技術創新與垂直整合優勢，深化與客戶的戰略夥伴關係，進一步鞏固在記憶體封測產業中的領先地位。

4.競爭情形：

華東科技的營運重心為記憶體 IC 封裝與測試，台灣地區的其他主要相關業者包括力成科技、南茂科技與福懋科技等。

相較於邏輯 IC 及類比 IC，記憶體產業的市場集中度顯著較高。根據 TrendForce（集邦科技）於 2025 年 2 月發布的統計數據，2024 年全球 DRAM 市場有超過九成的市占率由三星電子（Samsung Electronics）、SK 海力士（SK Hynix）、美光科技（Micron Technology）與鎧俠（Kioxia，前東芝記憶體公司）四家企業掌握，而 NAND Flash 市場亦有超過七成的市占率由主要業者壟斷。在此寡佔市場結構下，記憶體封測業者面臨的首要挑戰即為維繫穩定的客戶基礎。

全球記憶體市場在主要業者的策略調控下，謹慎維持供需平衡，並持續推進製程技術的發展。目前，DRAM 晶圓主流製程已進展至 1β 奈米，而主要 NAND Flash 供應商亦已成功開發超過 200 層以上的 3D 堆疊技術。既有記憶體廠商在提升製程良率與產能方面均有顯著進展。然而，中國的記憶體製造商長江存儲、合肥長鑫及睿力受限於美國對關鍵晶圓製造設備的嚴格管制，在 3D NAND Flash 與 DRAM 領域的發展面臨挑戰，導致技術升級進度受阻。中美科技戰的後續發展仍是全球半導體產業關注的焦點。

過去二十年來，記憶體 IC 市場發展迅速，DRAM 及 NOR/NAND Flash 的應用領域持續拓展，從電腦、消費性電子產品、伺服器，進一步延伸至智慧型手機與物聯網裝置，並逐步擴展至汽車應用領域，帶動記憶體產品線的不斷演進。同時，記憶體技術亦持續創新與升級，以 DRAM 為例，其技術世代已從 SDR、DDR1、DDR2 持續推進至 DDR4、GDDR5/6、LPDDR4/4x。為滿足 5G 及 AI 運算應用對高效能記憶體的需求，LPDDR5 於 2020 年底開始量產並逐步擴大產能，相較之下，DDR5 的推廣進度相對緩慢，直至 2022 年 Intel 與 AMD 推出支援 DDR5 的晶片組後，市場需求方才逐步提升。主要記憶體廠商三星電子、SK 海力士及美光均將研發與生產重點聚焦於資料中心與人工智慧（AI）應用領域。

近期，受惠於 AI 技術的快速發展，半導體大廠如 NVIDIA、AMD 及 Intel 相繼推出搭載高頻寬記憶體（HBM）的處理器平台，進一步推動記憶體業者加速 HBM 的技術研發與產能擴張。三大 DRAM 廠商 SK 海力士、三星電子及美光科技皆計劃於 2024 年大幅擴產 DDR5 與 HBM，以迎合資料中心與高階伺服器市場的升級需求。HBM 與 DDR5/LPDDR5 無疑將成為下一波 DRAM 市場成長的關鍵動力。

隨著記憶體 IC 技術的演進，封測技術與設備投資需求亦同步增加，具備長期投資能力與技術積累的記憶體封測業者逐漸減少。華東科技自成立以來，已累積將近新台幣 500 億元的資本支出，並建構完整且先進的記憶體封測產能。公司透過最佳化的營運管理，提供高效能的客戶服務，強化客戶關係，同時藉由優異的營運效率確保持續投資的能力，這正是華東科技深耕記憶體產業二十餘年所累積的核心競爭利基。

多年來，華東科技技術團隊與國際半導體大廠保持緊密合作，共同參與 DRAM 產業技術演進，累積深厚的工程服務與量產經驗。面對快速變遷的產業環境，華東科技將秉持技術創新精神，以客戶信任為基礎，專注於品質、成本、交期與服務的持續提升，致力於穩健經營，以達成永續成長的目標。

(三)技術及研究概況：

1.最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度	113 年度(註)	截至 114 年 3 月 31 日止(註)
研發費用	95,255	21,204

註：係依國際財務報導準則編製之合併公司財務資料

2.開發成功之技術或產品：

(1) QFN(無接腳式四方扁平封裝)。
(2) TSOP(薄形化小型封裝)。
(3) SOP8L(短形化小型封裝)。
(4) Flip-Chip(覆晶封裝)。
(5) LeadFrame type MCP(導線架型態晶片堆疊封裝)。
(6) mBGA(球型陣列承載器積體電路晶片尺寸封裝)。
(7) Advanced CSP-BGA(先進球型陣列承載器積體電路晶片尺寸封裝)。
(8) TrenchBGA(溝槽式球型陣列承載器積體電路)。
(9)BGA type MCP(球型陣列承載器積體電路型態晶片堆疊封裝)。
(10) FBGA(球型陣列承載器積體電路) 。
(11) Micro-SD(微型記憶卡)。
(12) Advanced MCP(先進晶片堆疊封裝)。
(13) Fine scribe line dicing for Cu wafer (銅材晶圓精細切割)。
(14) Dual Dies Package (雙晶片封裝)。
(15) Four dies Package (四晶片封裝)。
(16) Thin wafer as 60um and 50um (薄晶片 50um/60um)。
(17) Thin wafer as 40um thickness (薄晶片 40um)。
(18) Alloy wire for MCP and PoP (銀合金線取代金線)。
(19) Copper wire for Logic IC (銅線取代金線)。
(20) Fine gold wire as 15um(纖細的金線)。
(21) High ball count > 400 balls(高腳數)。
(22) SSD (固態硬碟封裝)。
(23) DBG (晶圓先切割後研磨)。
(24) Compression Molding(壓注模封模技術)。
(25) SAW Filter(產品封裝)。
(26) 8 dies package (八晶片封裝)。
(27) 10 dies package (十晶片封裝)。
(28) RDL wafer 40um grinding (線路重佈晶片 40um 研磨)。
(29) Package in Package for BGA。
(30) 2nd Mold for BGA (2 次封膠)。
(31) Dispensing (點膠技術)。
(32) RDL(重分佈技術)。

(33) Bumping(凸塊製程技術)。
(34) Multilayer Flip Chip(多層覆晶技術)。
(35) Embedded Substrate (嵌入式機板技術)。
(36) Power SIP (功率管理 IC)。

(四)長、短期業務發展計劃：

1.短期業務因應計劃：

面對現今記憶體產品的發展與變化，華東科技擬定以下三大重點，分別說明如下：

(1)鞏固 DDR4 與 LP DDR4 封測項目，並積極擴大 DDR5 業務：

DDR5 與 LPDDR5 記憶體的產品架構旨在因應高速運算需求，預期將優先應用於高效能伺服器與人工智慧（AI）工作站，以支援龐大數據處理。然而，對於運算速度與系統延遲要求較不嚴苛的應用而言，DDR5/LPDDR5 在運作過程中產生的熱量與雜訊可能增加系統設計的複雜性與成本，進而使 DDR4/LPDDR4 具長尾市場（Long Tail）價值。特別是在 PC 與智慧型手機以外的消費性電子產品，以及產品生命週期較長的物聯網（IoT）、工業控制（Industrial Control）與醫療設備領域，DDR4/LPDDR4 仍將維持主流 DRAM 規格。

華東科技自 2015 年與 2018 年分別投入 DDR4 與 LPDDR4 封測業務，並持續擴充相關封測產能，以提供高效且具成本優勢的解決方案，進一步鞏固市場定位。面對 AI 應用需求的快速成長，華東科技自 2023 年正式量產 DDR5，在 2024 年持續擴展，在 2025 年也將積極拓展 DDR5 相關領域，以掌握市場發展機會。

(2)強化封裝與測試一元化服務：

為滿足不同客戶與多元產品的封測需求，華東科技持續檢視並優化封裝與測試產能的最佳化配置，以強化一元化後段服務（Turnkey Service）。對客戶而言，一元化服務可簡化供應鏈管理流程，提高生產效率與成本效益；對華東科技而言，此模式不僅有助於提升營收與單顆產品平均價值，亦能優化產能調度，提高產能利用率，進一步改善營運毛利率，最終強化與客戶的長期合作關係，提升市場競爭力。

(3)縮短製造週期：

記憶體 IC 產品價格一向以高波動性聞名。為降低客戶的在途存貨價格波動的風險，本公司的生產運籌管理團隊與客戶充分合作，盡力達成客戶所期望的製造週期。

記憶體 IC 產品價格波動性高，易受市場供需變化影響，導致客戶面臨存貨價值波動風險。為協助客戶降低此風險，華東科技的生產運籌管理團隊與客戶密切合作，透過生產排程與供應鏈管理，致力於縮短製造週期，以滿足快速交付客戶的需求，提升市場應變能力，進而強化整體競爭優勢。

2.中長期發展計劃說明如下：

客戶關係為業務發展的核心關鍵，本公司秉持「以客戶需求為導向」的經營理念，並持續在以下三大構面精進與提升，以強化競爭優勢與市場地位：

(1)實現最佳成本效益：

儘管全球記憶體產業已呈現寡占態勢，且近年來價格走勢多為正向成長，但終端產品市場仍以「高規格、中價格」產品為主要成長動力，導致成本控制成為

整個供應鏈的核心考量。對於身處下游的華東科技而言，成本結構的精進與優化已是營運不可或缺的一環。

在封裝與測試業務的整體成本架構中，設備與材料為最關鍵的影響因素。因此，本公司將持續聚焦於設備組合與營運模式的最佳化，並同步推動製程與材料的改良與開發，以提供客戶兼具品質與成本效益的解決方案。

(2)持續投資技術與工程能力：

技術與工程能力為本公司的核心競爭力，面對產業環境的快速變化，本公司將持續加大製程研發與新世代生產設備的投資力度。透過前瞻性的技術能力以及研發與製程導入管理，本公司將協助客戶以最短的產品上市時間（Time to Market）贏得市場先機，並提供超越客戶期望的服務品質，進一步成為全球記憶體半導體企業在尋求後段封測夥伴時的首選。

(3)強化服務價值：

IC 封裝測試為 IC 產品進入市場前的最後一道關鍵加工程序，與客戶的技術研發與營運管理緊密相連。在封測服務的提供過程中，從 IC 封裝型態的設計、生產平台與材料的準備，到量產階段，每個環節均須與客戶緊密協作，充分展現雙方合作的廣度與深度。因此，良好的溝通成為封測代工服務中不可或缺的重要環節。

華東科技自我定位為客戶的「虛擬工廠」，特別設立專屬客服小組，全面負責客戶從產品開發、量產出貨到品質改善的每項細節，確保資訊的即時傳遞與問題的迅速解決，並透過最適切的溝通管道，提供高附加價值的服務，實現雙方的共同目標。

二、市場及產銷概況

(一) 市場分析：

1.主要產品銷售地區：

113 年度台灣地區占本公司總銷售額之 70%，國外地區占 30%。

2.市場佔有率：

華東科技的營運重心為記憶體 IC 封裝測試與模組代工，台灣地區業務性質相近的其他業者包括力成科技、南茂科技與福懋科技等。

依工研院 IEK 半導體研究部之 2024 年台灣整體 IC 封裝業及測試業(含晶圓測試與成品測試）產值為基礎，華東科技在封裝與測試之市場佔有率為 1.26%，資料詳如下表。

單位：新台幣億元

	華東科技營收	台灣該產業產值*	華東市佔率
封裝測試營收	78.59	6,235	1.26%

＊資料來源：TSIA；工研院產科國際所 (2025/02)

3.市場未來之供需狀況與成長性：

華東科技的業務以記憶體 IC 元件為核心，提供自記憶體 IC 封裝、成品測試至模組製造之一元化服務。以下針對記憶體封測業的需求與供給兩方面來說明：

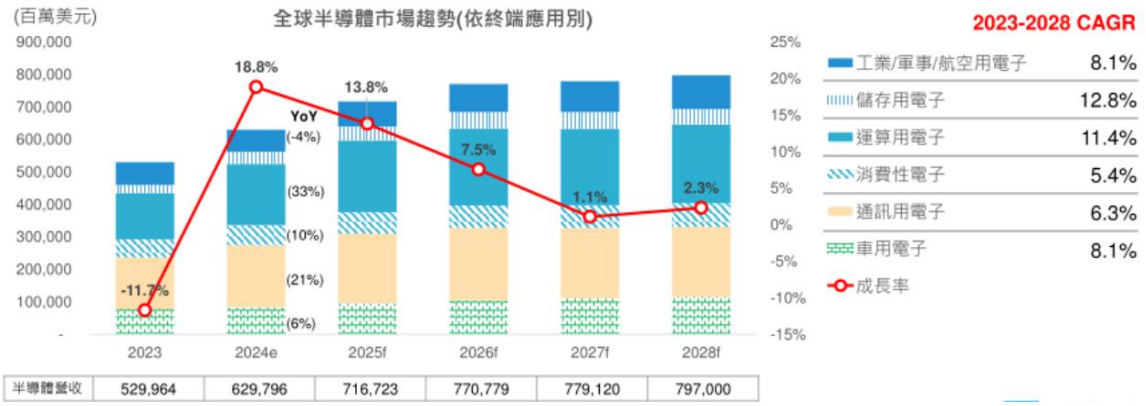
A.就需求面而言

隨著全球半導體市場的持續發展，記憶體產品在高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）、數據中心及通訊應用等領域的需求顯著提升，進一步推動記憶體封測產業的成長。根據研調機構 Gartner 的數據顯示(如下圖四)，2024 年全球半導

體市場規模預計為 6,298 億美元，年成長 18.8%。其中，2023~2028 年的年均複合成長率（CAGR）記憶體產品以 12.8%位居各類半導體應用增長之首，顯示出市場對高效能與高密度記憶體解決方案的強勁需求。

隨著 DDR5、LPDDR5 及 HBM 等高頻寬、低功耗記憶體技術的普及，記憶體封測技術面臨更高的挑戰，不僅需確保高速傳輸下的訊號完整性，還需符合更嚴苛的功耗與可靠性規範。此外，智慧型手機、車用電子及工業物聯網等領域對高效能、高頻寬、低功耗的記憶體解決方案需求日益增加，進一步驅動封測業者提升測試能力與製程優化。

在市場競爭與技術發展的雙重驅動下，記憶體封測業者須持續投資先進測試設備與自動化生產技術，以提升生產效率並降低成本，並在全球半導體產業鏈中保持競爭優勢。



圖四 2023-2028 年全球半導體市場趨勢(依終端應用別)

註：數據源自於 Gartner 於 2024 年 10 月所發布之數據

資料來源：TSIA, 2024/10

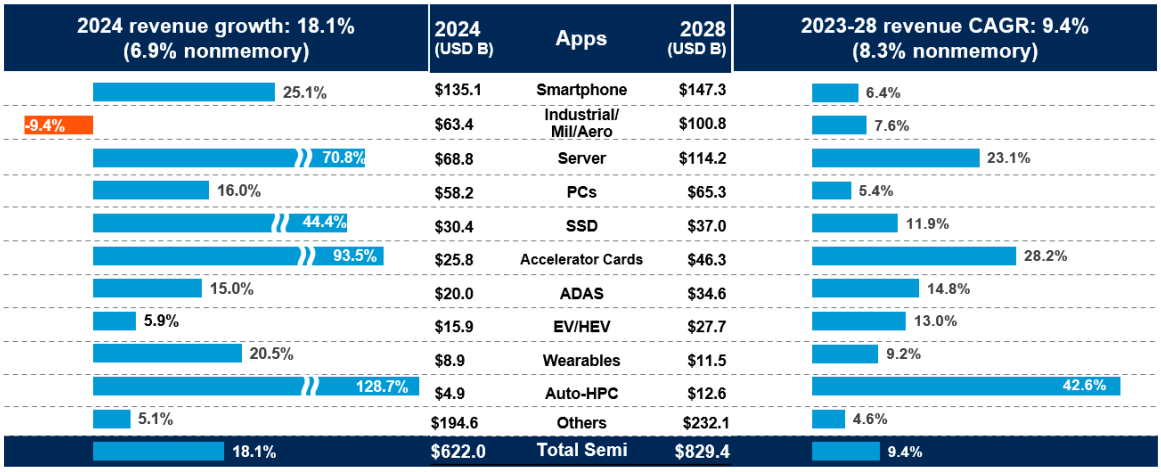
隨著全球半導體市場的快速發展，記憶體產品在各類應用領域的需求日益提升，進一步帶動記憶體封測產業的發展。

隨著人工智慧（AI）、大數據分析及雲端運算的廣泛應用，伺服器市場對高頻寬、低延遲記憶體產品的需求快速成長。根據研調機構 Gartner 針對全球半導體應用市場成長趨勢的預測(如下圖五)數據顯示，伺服器市場預計將從 2024 年的 688 億美元成長至 2028 年的 1,142 億美元，CAGR 達 23.1%。特別是 DDR5 及 HBM 記憶體技術的發展，使封測業者需應對更高頻寬與更嚴格的可靠性驗證需求，以確保產品在高效能運算場景中的穩定性。

車用電子市場將持續成長，其中 ADAS（先進駕駛輔助系統）與 EV/HEV（電動車/混合動力車）領域的記憶體需求尤為突出，CAGR 分別達 14.8% 及 13.0%。同時，工業及軍用/航太（Industrial/Mil/Aero）市場亦呈現穩健增長，預計 2028 年規模將達 1,000 億美元。這些應用對記憶體的可靠性與耐久性要求極高，促使封測業者強化高溫、高壓與長時間穩定性測試，確保記憶體產品在嚴苛環境下的穩定運作。

智慧型手機仍為記憶體市場的重要應用之一，預計 2028 年市場規模達 1,473 億美元。雖然增長趨勢相對放緩，CAGR 達 6.4%，但新興技術如 LPDDR5X、UFS 4.0 及 DRAM/NAND 整合解決方案的導入，使封測技術需進一步提升，以應對高速傳輸與低功耗設計需求。此外，穿戴式裝置（Wearables）市場亦有 9.2% 的 CAGR，顯示消費電子市場仍將維持穩定需求，帶動小型化、低功耗記憶體產品的封測需求成長。

隨著記憶體技術持續演進，記憶體封測業者需投入更多資源於高階測試設備、智慧製造及先進封裝技術，以提升測試效率並確保產品品質。此外，面對市場對高頻寬、低功耗、高可靠性記憶體的需求，封測業者將需積極調整產能配置，並強化與客戶的合作關係，以在快速變化的半導體市場中保持競爭優勢。



圖五　全球半導體應用市場成長趨勢

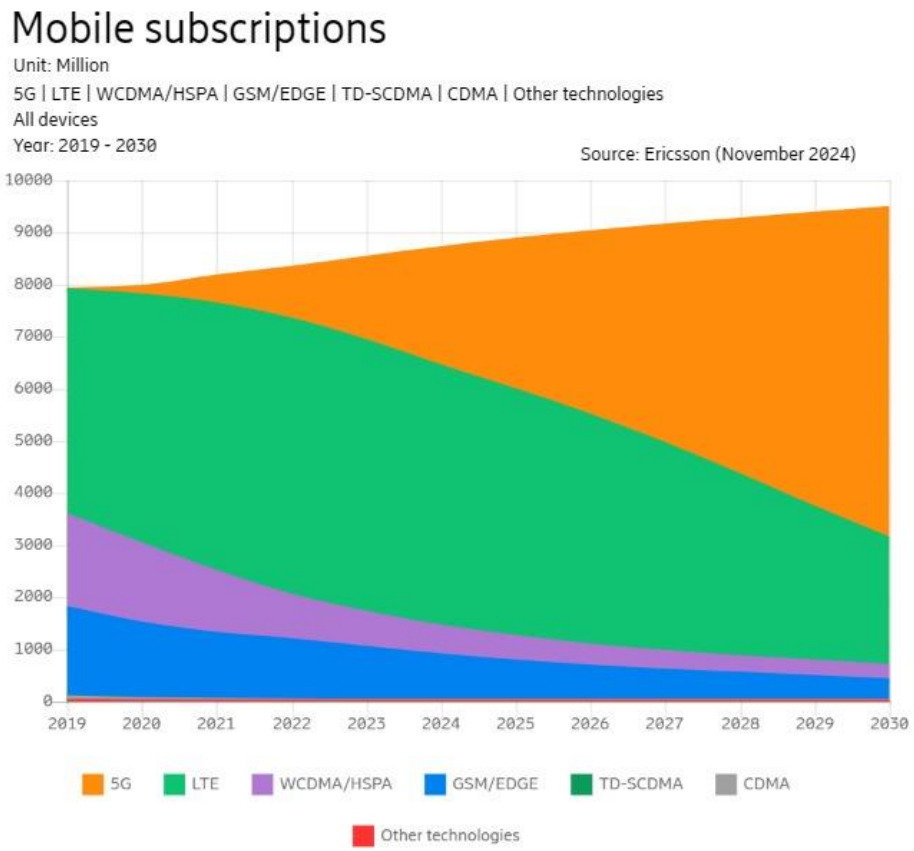
資料來源：Gartner (TSIA 提供, 2025/1)

儘管主要聯網裝置終端產品市場的出貨量增長空間有限，市場發展趨勢已逐步轉向技術升級與產品品質提升。其中，無線網路通訊技術的持續演進，成為驅動產業發展的核心動力。

根據《Ericsson Mobility Report》2024 年 11 月的預測，第五代無線通訊技術（5G）將成為未來成長的主要驅動力，其全球用戶數將從 2019 年的 43.2 億人增長至 2030 年的 63.5 億人。預計至 2027 年，5G 將正式取代全球第四代無線通訊技術（LTE，Long Term Evolution，簡稱 4G）成為市場主流。全球 4G 用戶數已於 2022 年達到峰值 53 億人，並將逐步減少至 2030 年的 24.4 億人。

預估至 2030 年，全球聯網裝置數量將達 87.9 億，包括智慧型手機、平板電腦及個人電腦等設備，其技術規格至少相當於或優於現今市面上的中高階產品。此外，行動網路數據流量亦將顯著成長，2024 年至 2030 年間，全球行動數據流量預計增長近 200%，其中 5G 網路預計於 2030 年底承載約 80%的行動數據流量。因此，寬頻物聯網（4G/5G）連結將於成為物聯網領域的主要連結技術。

綜上所述，未來幾年內，大量裝置的通訊介面將從現行的 2G 或 3G 升級至 4G，甚至 5G，並搭載足以發揮高速通訊效能的高端規格。即便在產業景氣波動的情勢下，5G 裝置與相關晶片的市場需求仍將持續增長，預計 2025 年將持續推動市場發展，為全球半導體產業及軟硬體供應商帶來重要發展契機。



圖六 2019-2030 年全球無線通訊網路用戶數成長趨勢圖

資料來源：Ericsson mobility report, 2024/11

備註：此處的數據不包括物聯網與固定式無線存取(Fixed Wireless Acess, FW)的連線數

搭載高容量 DRAM 不僅是對高效能的追求，更是因應高解析時代來臨的重要趨勢。全球主要電子設備，包括智慧型手機、平板電腦、個人電腦與電視等，其顯示面板解析度正持續邁向 UHD（Ultra High Definition）。根據 日本電子信息技術產業協會（JEITA） 的調查，預計至 2026 年，4K 解析度機型在全球電視市場的銷售占比將達 71%，較 2021 年提升約 10 個百分點。

特別是在疫情期間，高解析度影音內容的需求大幅成長。Netflix、Disney+ 及 YouTube 等串流媒體業者紛紛強化 4K 影片支援，進一步推動 4K 電視及顯示器銷售成長。預測至 2026 年，全球 4K 電視銷量將達 1 億 6,858.8 萬台，占整體平板電視市場（2 億 3,731.5 萬台）超過 70%。相較之下，更高階的 8K 解析度機型仍處於市場發展初期，預計 2026 年全球需求將達 993 萬台，雖較 2021 年的 72 萬台大幅成長，但占整體市場比例僅 4%，顯示其普及尚需時間。

此外，螢幕更新率（Refresh Rate） 亦成為顯示技術的重要發展方向。當更新率從 60Hz 提升至 120Hz，代表每分鐘處理的影像資訊量倍增，以提供更流暢的畫面顯示。伴隨高解析、高更新率顯示技術的發展，終端裝置內建記憶體的容量與規格提升已成市場趨勢，進一步帶動高階 DRAM 需求。

同時，2020 年 COVID-19 疫情爆發促使企業與政府單位加速數位轉型，以滿足遠端工作、線上教育及無接觸應用需求。這一轉變帶動更多裝置連結至網路，擴大物聯網（IoT）生態圈，並強化其在生活、教育、娛樂與工作等領域的影響力。人工智慧（AI）技術則成為支撐 IoT 平台的核心驅動力，進一步推動市場對高效能記憶體與高速運算技術的需求成長。

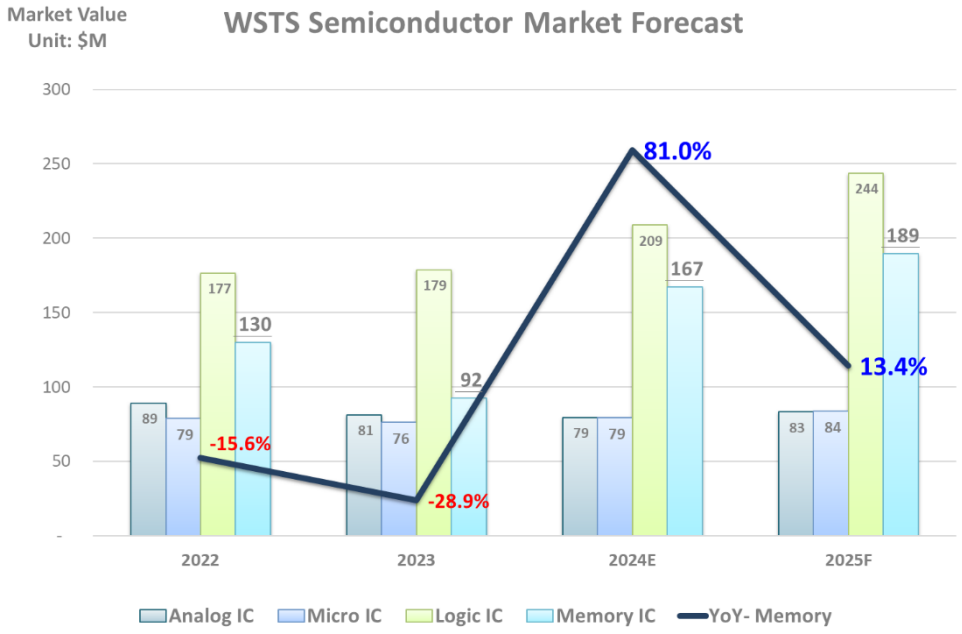
隨著人工智慧（AI）技術的蓬勃發展，處理器與記憶體技術面臨更為多樣化的挑戰，需根據不同應用場域選擇適切的 IC 等級與系統設計。例如，部分應用須處理龐大且複雜的影像、音訊及各類非結構化數據，並即時進行高速運算與決策，如 ChatGPT 及快速演進的高階 ADAS（先進駕駛輔助系統）與自駕技術。這類強調 低延遲（Low Latency）與高頻寬（High Bandwidth） 的應用，對記憶體的效能與容量要求極高。根據市場預測，AI 及高效能計算（HPC）應用將使系統所需的記憶體容量提升 5 至 8 倍，進一步推動記憶體市場成長。此外，部分裝置主要用於長期數據收集、監測與分析，並提供決策建議，如 智慧電網（Smart Grid）等 IoT 應用。目前，各類 AIoT（人工智慧物聯網）應用仍處於發展初期，未來如何針對不同應用場景提供最適化的軟硬體整合方案，將直接影響系統架構的設計演進及內建記憶體的發展方向。

隨著 大規模 AIoT 裝置陸續接入網路，也帶動雲端運算產業的快速成長，進一步催生龐大的雲端基礎設施需求。在 2023 年全球半導體產業面臨景氣波動之際，AI 應用成為市場關注的核心亮點，加速大型資料中心的建置步伐。伺服器市場對記憶體產品的需求亦同步提升，包括 高效能 DRAM 模組與固態硬碟（SSD, Solid State Drive），這些產品已成為記憶體廠商競逐的重要商機。

相較於智慧型手機，雖然伺服器的年出貨量相對較小，但單機所需記憶體容量為智慧型手機的數十倍，且對記憶體效能、穩定性與品質要求更高。因此，伺服器市場不僅是高附加價值的應用領域，亦將持續成為記憶體產業成長的重要驅動力。

根據世界半導體貿易統計協會(WSTS)預估(2024 年 12 月)，2024 年記憶體市場規模約超過 1,500 億美元，年成長 81%，預期到 2025 年記憶體銷售額可達約 1,890 億美元。展望後市，記憶體市場具有非常強勁的成長動能。

總體而言，在中短期內，智慧型手機、平板電腦與伺服器三大應用仍為 DRAM 市場需求的主要支柱。而從中長期來看，生成式 AI 應用的崛起 推動 AI 伺服器需求大幅增長，加上 穿戴式裝置、智慧汽車、智慧家庭 以及 萬物互聯（IoT）技術的普及，均將進一步帶動全球記憶體市場的發展。綜觀市場趨勢，記憶體產業可望在多元應用驅動下，維持穩定且持續的成長動能。



圖七 2022-2025F WSTS 全球半導體市場預測
註：數據源自於 WSTS 於 2024 年 12 月所發布之數據
資料來源：華東行銷業務部整理

B.就供給面而言

當前全球記憶體市場呈現寡占格局，由南韓三星（Samsung）、南韓 SK Hynix、美國美光科技（Micron）、日本 Kioxia 及美國 Western Digital 等五大業者合計掌握超過 90% 市場份額。在產能投資方面，各大業者採取相對謹慎的策略，使得市場供需調節機制較以往更加穩定，減少了過去因供需失衡導致的劇烈價格波動。

記憶體市場的應用面向涵蓋多個領域，其中伺服器、個人計算裝置與智慧型手機構成主要需求來源，此外，消費性電子與物聯網（IoT）裝置等新興應用亦推動市場發展。根據不同應用場景對效能、頻寬及功耗的要求，記憶體技術發展趨於多樣化，例如 DRAM 依應用需求細分為標準型 DRAM、LP DRAM（低功耗 DRAM）、Server DRAM（伺服器用 DRAM）及 Graphic DRAM（圖形 DRAM）；NAND Flash 則依製程、容量、效能、介面與可靠度有所區隔；NOR Flash 亦區分為 Serial NOR 及 Parallel NOR 兩大類型。

多元化的記憶體 IC 產品線進一步增加記憶體封測平台的技術與管理挑戰。記憶體技術的進步涵蓋單一封裝內建記憶體容量的提升、I/O 數與運作頻率的增加，以及封裝厚度的更嚴苛要求，這些變化驅動封測平台投資規模同步提升，對記憶體封測業者的規劃與管理能力提出更高要求。

目前，全球記憶體產業的重心集中於新製程技術的研發、產能擴展及良率提升，以確保技術領先優勢並增強成本競爭力。相對應地，記憶體封測市場亦趨於高度專業化，能夠提供先進封測服務的業者數量有限。在市場競爭格局轉變下，未來將更加強調技術能力、生產效率與品質管理，而隨著市場供應商數量減少，以往激烈的價格戰有望趨緩，促使產業朝向更健康且具長期發展潛力的方向邁進。

展望未來，行動裝置的普及將進一步推動雲端服務與應用的快速成長，包括影音串流、社交通訊、遊戲等應用，雙方需求將形成相互強化的趨勢。無論是行動端裝置還是雲端伺服器，皆需要更高效能與更大容量的記憶體來支援海量數據的運算與儲存，這正是記憶體產業持續成長的核心動能。

身為記憶體封測領域的專業服務供應商，華東科技將持續深化在記憶體封測技術、製造與服務方面的專業優勢，以提供全球市場最具競爭力的記憶體封測解決方案，並積極拓展未來成長機會，致力於成為全球業界中最具競爭力的記憶體封測服務夥伴。

4.競爭利基：

(1)穩固的策略聯盟

穩定的客戶關係是 IC 後段封測業經營的重要基礎，而 IC 製造廠有鑑於產品技術保密性與品質穩定性之必要，亦會選擇適當的 IC 後段封測廠長期合作。本公司自創立至今，客戶群囊括來自美國與台灣本土的重要記憶體廠商，並獲主要客戶認同而投資華東科技，使雙方的策略合作關係更為緊密。堅強的聯盟關係不但可確保本公司未來的發展與成長動力，並可藉此建立市場地位，為拓展國際大廠訂單奠定堅實基礎。

(2)從晶圓產出到成品之一元化服務

華東致力於提供自記憶體 IC 封裝、功能測試至模組製造的整合性服務，縮短客戶的製造週期並進一步降低存貨管理風險，簡化其供應鏈之管理，提升整體競爭優勢，實現雙方共創雙贏的目標。

(3) 完整而龐大的封測平台

作為專注於記憶體封測領域的企業，華東科技擁有完整的封測平台，能夠依據不同產品需求提供最適化的封測服務方案。此外，公司穩健的財務結構支撐持續投資發展，目前記憶體 IC 封測產能已躋身全球前五大。透過最佳化的生產規劃與管理，公司大幅提升產出效率，縮短生產週期，協助客戶更有效地進行出貨安排與營運管理。

(4)最佳化的封測平台組合

隨著記憶體技術的快速演進，封測平台的建置成本亦大幅提升。華東科技透過嚴謹的評估流程，優化封測製造平台，以提升不同產品線的製造共用性為核心目標。經由縝密規劃，不僅有效控制資本支出，亦提升產能配置的靈活度。在有限資本支出的前提下，透過產能擴充降低單位成本，為客戶提供最具成本效益的 IC 封測解決方案。

(5)穩定之財務結構

在半導體產業，「大者恆大」的市場規律同樣適用於封測領域。華東科技秉持穩健的財務政策，確保公司具備持續投資與長期發展的能力，並作為與策略夥伴深化合作、共創成長的重要基礎。

(6)優秀的研發能力

自成立以來，華東科技不斷投入技術研究與製程創新，並與全球領先的半導體業者建立長期合作關係，累積豐富的新產品研發與量產導入經驗。憑藉強大的研發實力，公司能夠迅速回應市場需求，在最短時間內提供完整的封測解

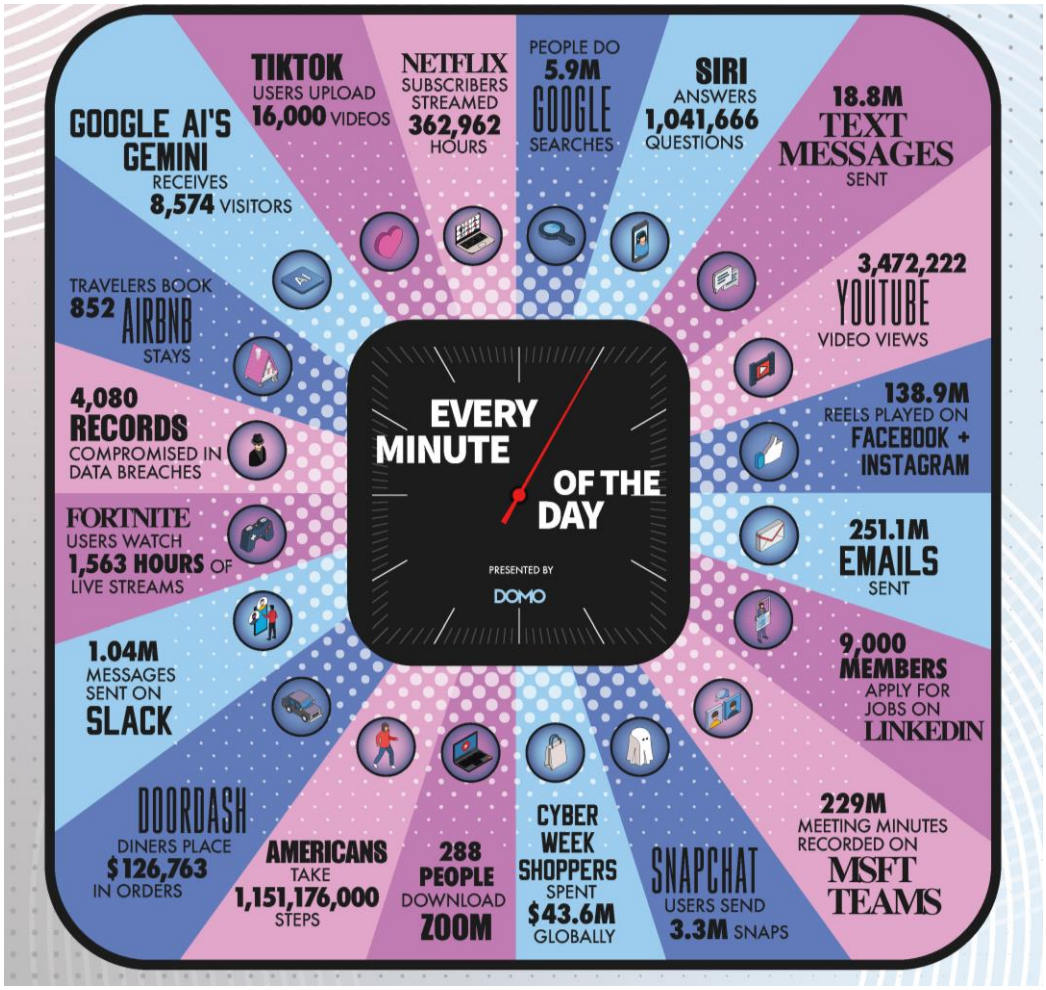
決方案，確保客戶獲得即時且高效的技術支援。

5.發展遠景之有利與不利因素與因應對策：

(1)有利因素：觀察全球科技界發展，我們確信以下兩個長期的重要趨勢將持續帶動記憶體市場的成長：

A. AIoT (AI+IoT，智慧物聯網)與邊緣運算的發展：

研究機構 Transforma Insights 估計(2021 年 7 月)，全球 IoT 連接數量將從 2020 年的 94 億個，持續快速成長，到 2030 年預計增加至 278 億個。可想而知，如此龐大的物聯網將創造許多數位資料。參考 DOMO 發布的每分鐘在網路產生的資料量統計報告- 2024 年版，可以看出網路上的活動十分多元且活躍，可預期相關資料量非常驚人。顯而易見，如何滿足求全球各領域所需要的運算量能與資料儲存量將是整個半導體與電子產業的重要課題。



圖八 每分鐘在網際網路上發生的事件與資料量

資料來源: DOMO, 2024/12

然而，人工智慧技術正在快速地變革與發展。隨著半導體技術的發展，資料計算能力大幅提升，且成本愈來愈親民，讓人工智慧不再受限於資料中心，逐步往邊緣設備滲透推展。就終端應用面來看，要求降低系統反應延遲的應用需求不斷增加，考量某些地區有網路連線取得困難或成本偏高的問題，以及保護使用者隱私或資料安全性等原因，影響所及，各種數據資料的處理與分析也逐步從雲端下放到邊緣進行，因而發展出具有邊緣運

算能力的智慧終端裝置。產業專家一致看好，邊緣運算將在今後 5~10 年蓬勃發展。Gartner 預估到 2025 年，將有高達 75%的企業資料在邊緣完成處理並儲存，以縮短網路傳輸的延遲，而能在邊緣端快速獲得資料分析結果。根據 Business insider 資料顯示，2022 年，AI 邊緣運算市場僅 156 億美元，但在未來七年之內，會呈現 35.7%年複合成長率，到了 2029 年將成長至 1074.7 億美元市場規模，是相當驚人的成長幅度，因此是業界高度矚目的市場應用。

2022 年末，由美國人工智慧研究機構「OpenAI」發表的聊天機器人—「ChatGPT」，擴大了人類對於人工智慧技術應用領域的想像與視野。2023 年無疑是生成式 AI (Generative AI) 元年。專家認為，「ChatGPT」的出現，跟智慧型手機、網際網路的出現一樣，將根深蒂固地改變人類的工作和生活。「ChatGPT」的「生成式 AI」(Generative AI)技術，讓任何人都可以用簡單的自然對話(而非程式語言)，指揮「機器學習模型」研究類似作品的數據，然後去創作各種內容，包括文字、圖像、音訊檔、影片、程式碼、甚至建築設計等形式。ChatGPT 無疑將開啟一個更寬廣的領域，以 AI 為工具，帶來更多數位化轉型的應用與機會。

2024 年被稱為「AI 手機元年」，各大手機廠商紛紛推出搭載 AI 功能的新產品，紛紛推出內建 AI 加速器的旗艦機種。AI 手機可支援更先進的影像處理、語音助理、即時翻譯、智慧應用管理等功能，並強化裝置端 AI 計算能力，提升使用者體驗與隱私保護。根據研調機構 IDC 表示：「Generative AI 在智慧型手機中的快速融入是行動史上前所未有的，市場滲透率預計將在前三年內超過 60%。然而，此一演變的最重大影響預計將在 2026 年出現。屆時中階裝置可望採用這項技術，從而實現 Gen AI 普及化的重大飛躍。雖然現在了解未來幾年將出現的所有使用案例還為時過早，但有一點可以肯定，Gen AI 將徹底改變我們與智慧型手機的互動方式。」

2024 年也被視為 AI PC 元年，英特爾在年初發表了搭載 NPU（神經處理單元）的 Meteor Lake 處理器，隨著搭載 AI 加速晶片的筆電與桌機相繼推出，更強大的計算能力與速度，成為大眾在公務與生活的最佳助理。

雖然人工智慧技術與應用推展可謂日新月異，就硬體而言，AIoT 裝置的基本組成不外乎四個部分，包括：感測(Sensing)、聯網(Connected)、處理(Processing)與顯示(Display)。其中，感測與聯網能力會帶來豐富的資訊需要處理，然後再依應用型態決定是否就地處理(Local processing)以及顯示功能的需求等級。因此，AIoT 裝置不僅代表 DRAM 應用市場的擴大，同時為了處理所收集到的資料，而帶動整個網路各層級系統所需要的計算與儲存能力。隨著現代生活與企業活動的數位化轉型的推展，我們可以預期有愈來愈多的應用導入，也代表未來市場仍有相當驚人的發展潛力。

展望未來，我們將會走向 AI 無所不在的世界，不需要人為控制、辨識，就可以自動判斷及執行的應用場域會越來越多。從傳統人與人的互動，增加越來越多 AI 與人的互動。AI 應用將持續帶動高頻寬記憶體(HBM)與高階伺服器的需求。無庸置疑的是邊緣運算 AI 與 AI 終端裝置的浪潮將會在世界各地蔓延。

B. 5G 網路服務的起飛

通訊技術是全球電子產業成長的主要驅動力之一。不論是智慧型手機、物聯網、或最夯的人工智慧，全部都需要通訊聯網能力。依循每十年一個大通訊世代的節奏，2019 年開始啟動的 5G 時代，無疑會是未來幾年通訊

產業發展的最大驅動力道。

相較於 4G 通訊技術，5G 通訊擁有以下重要特性：以 10Gbps 以上的資料傳輸速率支援數萬用戶，及大規模的並發連結能力及感測器網路的部署，在覆蓋率、頻譜效率及低延遲性遠勝於 4G。因此專家指出，5G 的重要應用場景非常廣泛，包括雲端圖形計算、車聯網、智慧製造、智慧能源、無線醫療、無線家庭娛樂、聯網無人機、社群直播網路、個人 AI 助理、智慧城市等。現階段 5G 網路部署上仍有許多挑戰，包括技術與商業上的考量。但不容置疑的是許多創意與服務都有機會藉由 5G 網路而成為現實。

未來幾年，隨著 5G 網路的起飛，單單是通訊網路的建置對半導體市場就是一個極大的商機。然後，再擴大到使用 5G 通訊的廣大終端設備群，也就是具有不同等級智慧能力的 AIoT 裝置(AI+IoT，智慧物聯網)，這是非常驚人的市場規模。

參考 Ericsson Mobility Report(2024 年 11 月)的預測，5G 服務在 2019 年啟用，到 2029 年，透過手機、平板與電腦上網的用戶數預計達到 50 億。再加上其他 AIoT 裝置，包括：小至一個電燈開關，汽機車、工廠與住家裡的機器人、施工的重型機械等各式各樣的 AIoT 裝置。每個 AIoT 裝置上會需要不同的感測能力、計算能力、資料處理能力與存儲容量，這是半導體產業整體長遠發展的重要驅動力。

可以確信，未來 5 至 10 年內，驅動半導體市場發展的關鍵技術將由人工智慧（AI）、物聯網（IoT）及第五代行動通訊技術（5G）所構築的生態系統所主導。而這些技術的應用範疇不僅侷限於消費性市場，更將廣泛延伸至工業、商業、醫療及政府公共服務等領域，推動數位轉型與智慧化發展。半導體產品身為各項應用產品的底層基礎，隨著其技術日新月異的創新與進步，長期來看產業發展前景是正面可期的。

(2)不利因素及其因應對策：

A.龐大的先進技術與設備投資

隨著無線通訊技術與網路的快速發展，眾多創新應用得以迅速普及至全球市場，持續影響並重塑消費者需求、終端產品的設計與製造，進而推動最上游的半導體產業升級。一方面，終端產品在功能、效能、成本及外觀設計上的提升，加速記憶體技術與封裝測試技術的發展，帶動相應的封測技術與設備投資規模呈倍數增長；另一方面，終端產品種類持續擴展，使記憶體的應用領域與產品線日益多元，顯著提升記憶體封測平台的複雜性，也同步加大封測業者在技術升級與設備佈局上的投資風險。

因應對策：

面對瞬息萬變的產業環境，本公司致力於提升產品開發速度與成本控制，並透過研發與製程能力的雙軌並進，以確保技術升級的效益最大化，同時有效管控資本支出與投資風險。

1. 研發創新與技術規劃

本公司持續強化技術研發與產品開發管理，縮短產品自規劃至量產上市的時程，以提高市場導入初期的競爭優勢與獲利空間。此外，積極掌握最新技術發展趨勢，確保技術世代的無縫銜接，以降低設備投資的不確定性。這些策略的成功推動，仰賴本公司與客戶之間的緊密合作與高效協同。

同時，本公司攜手客戶與供應商，共同導入新材料（如合金線），優

化物料規劃與資源運用，並建立穩定的產業夥伴關係。透過供應鏈整合，提升資源共享與風險共擔機制，增強整體產業鏈的抗風險能力與市場競爭力。

2. 製程能力提升與生產管理優化

本公司運用大數據分析，對機台運行參數、產品良率、生產週期與產能效率等關鍵數據進行交叉比對，提升生產線運作效率與整體管理效能。此外，透過彈性產能配置與可擴展的生產平台，確保生產組合的靈活調整，以因應產品線的多元化需求，降低技術升級帶來的設備投資風險。

為進一步提升營運效益，本公司採取最小化設備組合投資策略，以滿足多元化的客戶需求，同時降低新產品導入的資本支出與風險，確保最佳經營效益，並提供客戶最具成本競爭力的封測解決方案。

3. 風險管理與營運穩定性

本公司自平台建構、產品開發至業務拓展，均採用系統化分析與監控機制，使管理團隊能即時掌握投資風險，並預先規劃因應策略。此外，透過客戶組合與產品組合的動態調整與精細管理，進一步降低整體營運波動風險，確保業務穩健成長，並持續鞏固市場領先地位。

B.人力質量的限制

隨著台灣人口結構逐步邁向少子化,勞動市場面臨勞動力供給減少的挑戰，進而影響基層工程技術人力的充足性與穩定性。此趨勢對產業發展及競爭力帶來潛在影響，需透過多元策略積極應對，以確保人力資源的持續性與技術傳承。

<u>因應對策：</u>

隨著台灣少子化趨勢加劇，勞動市場面臨人力供應短缺的挑戰，對產業發展與技術創新產生潛在影響。為確保企業穩健經營與持續提升競爭力，本公司提出以下綜合因應對策：

首先，強化產學合作與人才培育。本公司積極與國內外高等院校及職業訓練機構建立長期合作夥伴關係，推動實習、見習計畫及專業技能培訓計畫，以培育符合產業需求的技術人才。同時，透過建教合作計畫，及早接觸並招募具發展潛力的年輕人才，以確保人力資源的穩定供應。此外，依據政府相關規範，本公司亦適度引進外籍勞工，以補充特定職能之人力需求，確保產線穩定運作。

其次，推動智慧製造與自動化技術。本公司積極導入智慧工廠概念，透過先進的自動化生產設備及數位管理系統，提高生產效率並降低對人工作業的依賴。藉由網路連結廠內設備，強化自動化控制與管理功能，同時優化作業流程，簡化人員操作並提升生產穩定性。此外，本公司導入大數據分析技術，透過即時監測機台運行狀況，整合生產效率、良率及生產週期等關鍵指標，實現智慧化決策，以提升整體營運效能。針對關鍵生產站點，本公司亦逐步引進自動化機械手臂，以提升作業人員的生產力並減少人力需求壓力。

此外，完善人才引進與留任機制。本公司致力於打造優質的工作環境與完善的薪酬福利制度，以吸引並留住優秀人才。同時，透過員工教育訓練及職能發展計畫，促進員工與企業共同成長，提升內部人力資源的專業能

力與穩定性。

最後，建立內部知識傳承與技能提升機制。本公司透過知識管理系統（KM），確保資深技術人員的經驗與專業知識得以有效傳承，並持續舉辦內部培訓與外部技術講座，強化員工技能，提升整體競爭力。

綜上所述，本公司透過上述策略，積極應對勞動力與基層工程人力短缺的挑戰，確保企業競爭優勢，並持續鞏固在全球半導體產業中的地位。

C.ESG 議題

ESG（Environmental, Social, Governance）為環境保護（E）、社會責任（S）及公司治理（G）的縮寫，已成為衡量企業永續經營的重要指標。相較於傳統企業評估模式主要關注每股盈餘（EPS）及財務表現，ESG 則強調企業在環境、社會及治理層面的綜合表現，並作為投資人及利害關係人評估企業永續發展能力的關鍵依據。

自 2021 年聯合國氣候變遷大會（COP26）以來，「淨零碳排」已成為全球各國及企業積極推動的重要目標。面對日益嚴格的國際減碳法規，企業需關注供應鏈管理與永續經營策略，以確保符合全球減碳趨勢。半導體產業作為電子產品製造的重要產業鏈，其生產過程高度依賴水電資源，並涉及溫室氣體排放及廢棄物處理，因此減碳議題對產業發展影響深遠。

目前，全球資訊科技（IT）龍頭企業，如 Apple、Google、Microsoft 及 Amazon 等，已陸續對其供應鏈提出減碳目標，要求合作夥伴共同承擔環境責任。身為半導體供應鏈的一環，華東科技將積極響應全球減碳趨勢，將 ESG 永續發展原則納入營運規劃，推動低碳轉型，確保企業在全球市場中的競爭力與長期發展。

<u>因應對策：</u>

華東科技秉持企業永續發展理念，因應 ESG（環境保護、社會責任、公司治理）與淨零碳排放的國際趨勢，全面整合環境管理、供應鏈協作及技術創新，確保企業長期競爭力並強化全球市場地位。本公司將從以下面向推動減碳行動計畫，以落實低碳轉型目標：

1. 綠色工廠布局：
   透過碳排放的盤點查核，掌握華東工廠的熱點，導入低碳建築概念，針對建物的結構、空調與冷卻系統、照明及水資源管線等系統，進行建置改造，讓軟硬體層面都更符合低碳目標。
2. 綠色供應鏈管理：
   身為封裝測試業者，我們有許多關鍵原料與設備的合作夥伴，因此在產品碳足跡的優化上，華東不僅提出供應商規範，也會積極與供應商合作研擬減碳策略。
3. 綠色產品與低碳製程：
   以降低能源消耗與氣體排放為考量，從產品與製程著手進行設計改善。華東科技研發團隊針對封裝結構，耗能製程等層面進行改善，以優化單位產品的能源消耗量與碳排，減緩對環境造成的衝擊。
4. 綠電導入與再生能源布局：
   因應臺灣 2050 淨零排放的目標與政策，以及來自終端客戶的要求，華東科技已著手進行綠電的採購計畫。
5. 環保意識推廣與社會責任實踐：
   強化內部員工環境意識，推動環保教育與培訓計畫，鼓勵員工積極

參與社會公益及環境保護活動，履行企業社會責任。同時，本公司將與相關機構合作，共同推動產業鏈的永續發展，促進企業與社會的共同成長。

透過上述綜合因應策略，華東科技將全方位落實 ESG 永續發展目標，積極響應全球減碳趨勢，確保企業在國際市場中的永續競爭力，並為全球環境保護與產業升級貢獻力量。

D.地緣政治對半導體供應鏈布局的影響

近年來，美中兩國在多次會談與協商後，仍持續採取提高關稅、貿易制裁及限制前瞻技術獲取等措施，使雙方在科技領域的競爭愈發激烈，至今未見緩解跡象。此外，俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治衝突頻發，加上全球供應鏈甫自 COVID-19 疫情影響中恢復，進一步加深了全球經濟與產業供應鏈的不確定性。

在此背景下，全球半導體產業長期奉行的專業分工與自由貿易模式面臨挑戰，產業龍頭企業對供應鏈韌性的重視程度大幅提升。為確保關鍵技術與產業供應鏈的安全，各國政府相繼推出更具力度的產業扶植政策，積極強化本土半導體供應鏈，尤其在製造環節投入更多資源，以確保產業自主性與競爭力。在此全球產業格局重塑的趨勢下，半導體產業須審慎應對供應鏈變革，以維持穩定發展與全球競爭優勢。

因應對策：

華東科技目前的製造佈局主要設立於台灣與中國，並採取雙軌並進的策略，以滿足全球客戶的多元需求。然而，隨著國際市場環境變化，部分國際客戶已開始提出台灣及中國以外之製造基地規劃需求。

展望未來，華東科技將秉持與客戶共同成長與互利共榮的原則，持續強化與客戶的緊密合作，並評估海外製造據點的設立或合作可行性，以確保供應鏈韌性與市場競爭優勢，進一步拓展全球業務版圖。

E.美元匯率波動

華東科技目前約 3-4 成的營收以美元計價，因此美元兌新台幣（USD/TWD）匯率的波動對本公司整體營收與獲利具有直接影響。根據圖八所示之美元兌新台幣匯率走勢，過去兩年呈現上升趨勢。2023 年 3 月至 2023 年 10 月美元兌台幣逐步走強，主要受到美國聯邦準備理事會（Fed）持續升息的影響，推動美元匯率上升。2023 年 10 月至 2024 年 2 月匯率出現較大幅度修正，反映市場對美國經濟前景的不確定性與對聯準會貨幣政策轉向的預期。2024 年 2 月至 2025 年 3 月美元再度升值，並於 2025 年初接近 33.1 TWD 的高點。此一趨勢主要受到美國經濟數據表現強勁、聯準會降息時機未明確等因素影響，導致市場對美元需求上升。

圖九　2022/2-2025/2 美金對台幣匯率走勢圖

資料來源：XE.com, 2025/2

因應對策：

在全球化程度極高的半導體產業中，匯率變動為影響企業獲利的重要關鍵因素之一。對華東科技而言，無論是機械設備與原物料的採購，或是服務收入，皆有相當比例涉及外幣交易。因此，針對持有之外幣進行適當的避險管理，為確保公司財務穩定性與獲利表現之重要策略。本公司將持續關注外匯市場動態，並採取適宜的風險管理機制，以降低匯率波動對營運績效之影響。

(二)主要產品之重要用途及產製過程：

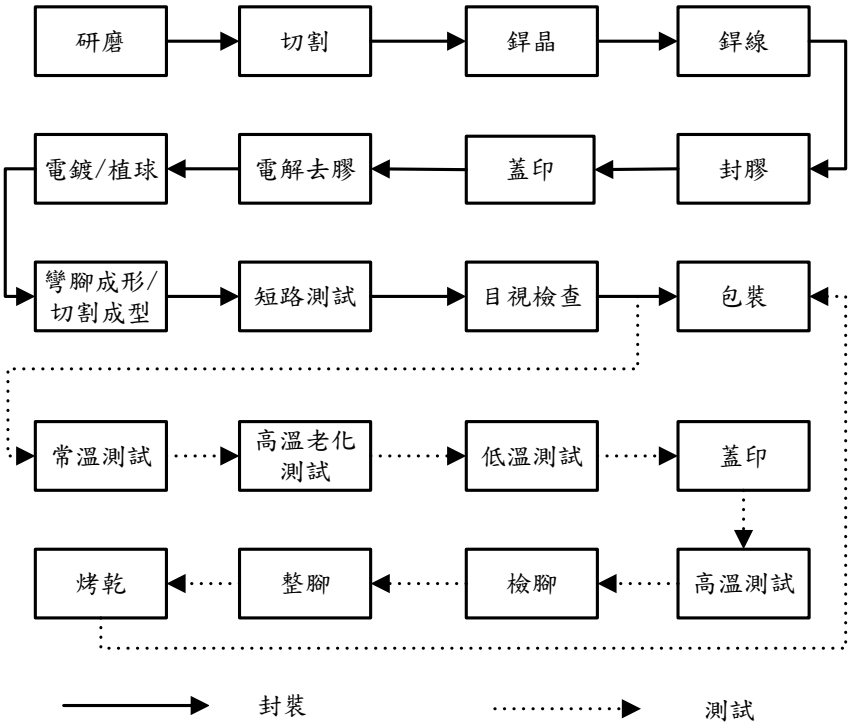
1.主要產品之重要用途：

以下將針對本公司主要服務內容之用途予以說明：

服務	用途
IC 封裝	■ 保護 IC 內精細的電路，不受外界接觸、溫度、溼度的干擾 ■ 確保訊號完整，並提升整體的良率 ■ 便於 IC 後續的操作與處理
功能測試	■ 驗證效能，以確保 IC 功能如原始設計 ■ 依產品電性功能作分類 ■ 降低退貨，節省後續維修成本

2.產製過程：

積體電路(IC)之封裝測試



(三) 主要原料之供應狀況：

本公司主要原物料項目為基材(BT-Substrate) 、導線架(Lead Frame)、金線(Gold Wire)、膠餅(Compound)、膠膜(DAF/FOW)、銀膠(Epoxy)等，並與主要供應廠商保持良好之合作關係，以維持長期且穩定的供貨情形；並與廠商協議將部份原物料維持機動供貨計劃以降低庫存。主要貨源來自台灣、日本及韓國。

(四) 最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例：

1.最近二年度任一年度中曾占進貨總額百分之十以上廠商名稱

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年				截至 114 年度第一季(註)			
項目	名　　稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	D	256,857	14	無	D	262,448	13	無	A	52,894	11	無
2	E	159,416	9	無	A	221,349	11	無	D	49,684	10	無
3	其他	1,371,329	77		其他	1,560,821	76		其他	377,136	79	
	進貨淨額	1,787,602	100		進貨淨額	2,044,618	100		進貨淨額	479,714	100	

註：係依國際財務報導準則編製之合併公司財務資料。

增減變動原因：本公司主要原物料均有二家以上供應商，以確保採購彈性並分散來源，故供應商之變化尚屬合理。

2.最近二年度任一年度中曾占銷貨總額百分之十以上客戶名稱

單位：新台幣仟元

	112 年				113 年				截至 114 年度第一季(註)			
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	華邦	3,060,239	42	本公司董事	華邦	3,337,904	42	本公司董事	華邦	674,493	38	本公司董事
2	D	1,722,945	24	無	D	1,727,530	22	無	A	446,926	25	無
3	A	920,285	13	無	A	1,562,273	20	無	D	410,275	23	無
	其他	1,572,600	21		其他	1,231,749	16		其他	261,357	14	
	銷貨淨額	7,276,069	100		銷貨淨額	7,859,456	100		銷貨淨額	1,793,051	100	

(註) 係依國際財務報導準則編製之合併公司財務資料。

增減變動原因：本公司銷售客戶主要係隨市場開拓及客戶需求而變化，其變化尚屬合理。

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分佈比率：

項目		112 年度	113 年度	截至114年5月20日止
員工人數	直接員工	1,816	1,667	1,615
	間接員工	1,108	1,048	1,025
	合計	2,924	2,715	2,640
平均年歲		34.43	35.38	35.42
平均服務年資		5.85	6.54	6.80
學歷分佈比率	博士	0.0%	0.0%	0.0%
	碩士	2.5%	2.8%	2.8%
	大專	50.8%	52.7%	53.5%
	高中	29.9%	30.5%	28.8%
	高中以下	16.8%	14.0%	14.9%

四、環保支出資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所遭受之損失(包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項)、處分總額與因應措施：無。

(二) 未來因應對策包括改善措施及可能之支出：無。

五、勞資關係

(一) 員工福利措施及其實施情形：

本公司自 101 年~107 年及 109 年~112 年榮獲經濟部加工出口區優良勞資關係事業單位獎，全體從業人員平日享有之福利計有：

1.三節禮金
2.婚喪喜慶補助
3.員工旅遊
4.社團補助
5.員工團體保險
6.定期健康檢查
7.交通車/宿舍/員工餐廳

8.完整教育訓練計劃
9.員工分紅制度
10.育才計劃

(二) 員工進修、訓練與其實施情形：

本公司培訓員工職能方式簡述如下，並於 99 年榮獲行政院創造就業貢獻獎，及自民國 96 年至 101 年皆榮獲經濟部加工出口區人力培訓績優單位獎。

1.新人教育訓練
2.公司內訓
3.在職訓練
4.公司外訓
5.集團內訓

(三) 退休制度及其實施情形：

本公司訂有員工退休辦法，並將依照勞基法及勞工退休金條例及員工自由選擇之結果，依規定分別按薪資總額之 2%及 6%提撥退休準備金及存入員工個人退休金專戶,選擇舊制則撥入勞工退休準備金監督委員會管理專戶並以其名義存入台灣銀行(原中央信託局於九十六年間併入台灣銀行)；選擇新制則依規定撥入勞保局之員工個人帳戶。

(四) 勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.勞資協議：

本公司定期召開勞資會議,並函報主管機關以達到雇主與勞工溝通橋樑，並自民國 101 年至 107 年及 109 年~112 年皆榮獲經濟部加工出口區勞資關係優良單位獎。本公司刻正與工會協商中，故尚未簽訂團體協約。

2.工作環境與員工人身安全保護措施：

為期達到「零災害、零污染」之目標，本公司除遵循法規實施勞工安全衛生管理外，更結合 ISO14001、ISO45001 納入環保、安全、健康及風險管理業務，整合為環安衛管理系統，以期提高整體管理績效，塑造良好工作環境，保障員工安全與衛生：

(1) 安全衛生管理組織與管理人員：
公司設置職業安全衛生委員會，每季召開會議，檢討及訂定職安衛管理方針。公司設置安全衛生管理單位，編制職業安全衛生業務主管、安全管理師、衛生管理師、及安衛管理員，並經各區勞動檢查單位核備在案。

(2) 制訂安全衛生工作守則及作業標準程序，供員工遵循作業。

(3) 機械及設備：
依日、週、月、季、半年、年檢點、檢查項目實施自動檢查，以確保機械設備操作安全。

(4) 工廠設施：
實施主管之走動管理及職安衛人員定期巡檢廠區安全，另設置有線上安全提報系統，供員工隨時提報廠內安全缺失，追蹤改善成效，以維護設施之完善。

(5) 作業環境：
實施5S 管理，精進工廠環境維持制度；依法定期實施作業環境測定。

(6) 防護設備：

檢討機械設備危險點，確實加設防護裝置，並依作業別配發個人防護具，以保障員工安全與健康。

(7) 教育訓練：

依法實施新進人員訓練、員工在職教育訓練、健康講座、衛教及緊急應變課程;特殊作業資格者,依法取得相關證照並定期安排回訓。

(8) 健康管理：

新進人員工作前、特殊作業人員每年、一般作業人員每三年實施健康檢查，藉以瞭解員工健康情形，作為員工工作調換分派之依據，落實健康管理計劃進而改善工作環境以維持及促進工作者的健康及工作能力。

(9) 消防安全：

依消防法之規定，設置完善之消防系統，並依法定期檢查申報；並定期實施緊急應變演練及疏散訓練。

(五) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失及因應措施：

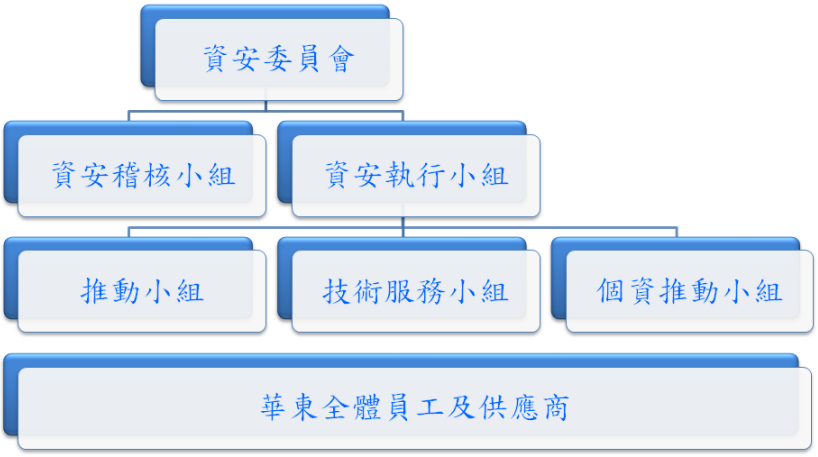
處分日期	處分字號	違反法規條文	違反法規內容	處分內容
113/05/29	經園高環字 第 1130101394 號	勞動基準法 第 24 條第 1 項 第 32 條第 2 項 第 35 條	1.雇主延長勞工工作時間者，其延長工作時間之工資應依法令標準加給。 2.雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時；延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時。 3.勞工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。	罰鍰新台幣 14 萬元
113/11/14	經園高環字 第 1130103047 號	勞動基準法 第 24 條第 1 項 第 24 條第 2 項	1.雇主延長勞工工作時間者，其延長工作時間之工資應依法令標準加給。 2.雇主使勞工於第三十六條所定休息日工作，工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一以上；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二以上。	罰鍰新台幣 10 萬元

(六) 目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

未來本公司深信企業之得以永續經營與持續成長全在於「人」，故成立之初即首重人性化管理，並建立各項福利制度，以實踐共存共榮之理念；因此，本公司自成立迄今，勞資雙方始終具有共識，未曾產生任何糾紛。

六、資通安全管理

(一) 資通安全風險管理架構：



(二) 資通安全政策：

本公司為符合客戶資訊安全及公司核心價值要求導入國際資訊安全標準，並藉由通過國際資訊安全認證以強化本公司資訊安全管理與措施，確保系統、設備、網路運作順暢，達到資料處理、傳送、儲存及流通之機密性、完整性、可用性之管理目標；本公司之資訊安全委員會針對組織內部所使用之智慧財產權、營業秘密、個人資料等，實施全面性之管理，堅持提供資訊安全運作之環境以保障所有相關人員之權益。本公司於 104 年導入 ISO27001 資通管理系統，並定期取得 ISO27001 資訊安全認證，目前證書有效期間為 113 年 5 月 7 日至 116 年 5 月 6 日，藉以強化資通安全事件之應變處理能力，保護本公司各項重要機密資訊不外洩。

(三) 資通安全具體管理方案：

1. 前言

在數位化時代，資訊安全已成為企業永續經營的關鍵。為保障客戶資料、企業機密及系統穩定運行，本公司秉持「安全第一」的理念，制定本資訊安全具體管理方案，並持續優化資訊安全管理體系，以應對日益嚴峻的網路安全威脅。

2. 目標

●建立完善的資訊安全管理體系，保障資訊資產的機密性、完整性和可用性。
●提升全員資訊安全意識，降低人為操作風險。
●有效防範和應對各類資訊安全事件，將損失降至最低。
●遵守相關法律法規和行業規範，維護企業信譽。

3. 管理範圍

本方案適用於 本公司所有部門、員工、合作夥伴及第三方服務提供商，涵蓋所有資訊系統、網路設備、數據資料及相關作業環境。

4. 具體管理措施

(1) 組織與制度

●成立資訊安全管理委員會，負責資訊安全策略制定、監督和評估，並定期召開會議(每月 1 次)。
●設立資訊安全專責部門或人員，負責日常資訊安全管理工作。
●制定並完善資訊安全管理制度，包括但不限於：
。資訊資產管理辦法
。資訊安全事件管理辦法

◦資料備份與恢復管理辦法
◦系統存取控制管理辦法
◦網路安全管理辦法

●定期進行資訊安全風險評估(每年至少 1 次)，並根據評估結果調整管理措施。

●定期召開管理審查會議(每年 1 次)，審查資訊安全管理體系的有效性。

(2) 人員安全管理

●加強員工資訊安全意識教育，定期進行資訊安全培訓(每年至少 1 次)。

●與員工簽訂保密協議，明確資訊安全責任和義務。

●實施最小權限原則，嚴格控制員工對資訊系統和數據的存取權限。

●建立員工離職管理制度，及時收回離職員工的系統權限和設備。

●實施人員進出管制，並使用門禁刷卡系統記錄進出人員資訊。

●定期宣導資安事宜，提升全員資訊安全意識。

(3) 系統與網路安全

●部署防火牆、入侵偵測系統等安全設備，防範網路攻擊。

●定期進行系統漏洞掃描和修補，及時更新系統和應用程式(使用 WSUS 系統進行安全更新)。

●實施強密碼策略，並定期更換密碼。

●對重要數據進行加密儲存和傳輸，防止數據洩露(使用 SSL-VPN 加密連線機制)。

●建立完善的資料備份和恢復機制(使用資料備份系統)，確保數據安全。

●每年至少進行 1 次弱點掃描，及時發現和修復安全漏洞。

●部署防駭預警設備，及時發現和應對網路攻擊。

(4) 應用安全

●在軟體開發過程中，遵循安全編碼規範，避免安全漏洞。

●對上線前的應用程式進行安全測試，及時發現和修復安全問題。

●加強對第三方應用程式的安全管理，評估其安全風險。

(5) 物理安全

●對機房、伺服器等重要設施進行物理隔離和訪問控制。

●安裝監控設備，對重要區域進行 24 小時監控。

●定期進行安全檢查，及時消除安全隱患。

(6) 事件應變

●建立資訊安全事件應變機制，制定應變計畫。

●成立資訊安全事件應變小組，負責事件處理和調查。

●定期進行資訊安全事件應變演練，提升應變能力。

●及時向相關部門報告資訊安全事件，並配合調查。

(7) 資產管理

●使用資產管理系統(例如：SMART IT)對資訊資產進行全面管理。

●建立中央儲存空間，集中管理重要資料。

(8) 安全稽核

●定期進行內部安全稽核(每月 1 次)，檢查資訊安全管理措施的執行情況。

●定期進行交叉安全稽核(每季 1 次)，由不同部門或外部專家進行稽核。

5. 保密管理

(1) 保密範圍

以下資訊都屬於公司機密，未經授權不得對外洩露或傳播：

●薪資資訊：包括個人薪資、獎金、福利待遇及其他與薪酬相關的資料。

●人事資料：如離職單、員工考核記錄、人事異動等。

●研發資料：包括產品設計、技術專利、研發進度、測試數據等。

●商業機密：如客戶名單、合約內容、行銷策略、財務報表等。

●其他機密資訊：公司內部會議記錄、未公開的計畫或政策等。

●已被各單位列為機密之資訊。

(2) 保密義務

●員工責任：所有員工均有義務保護公司機密資訊，不得將機密資料用於非工作目的，或向未經授權的第三方透露。

●離職後義務：即使離職後，員工仍須遵守保密協議，不得洩露任職期間知悉的機密資訊。

●外部合作：與外部單位合作時，需確保資訊傳遞的安全性，必要時應簽署保密協議(NDA）。

(3) 可能觸犯的法規

洩露公司機密資訊可能涉及以下法律責任，請同仁務必謹慎：

●《營業秘密法》：洩露營業秘密可能面臨民事賠償及刑事責任，最高可處五年以下有期徒刑或併科罰金。

●《個人資料保護法》：未經授權處理或洩露個人資料，可能面臨行政罰鍰及民事賠償。

●《勞動基準法》：違反保密義務可能構成違反勞動契約，公司有權追究責任並要求賠償。

●《刑法》：若洩密行為造成公司重大損失，可能涉及背信罪或其他刑事責任。

(4) 防範措施

●文件管理：機密文件應妥善存放，使用後即時歸檔或銷毀，避免遺失或外流。

●電子資料：電子檔案應設置存取權限，並避免透過未加密的管道傳輸。

●社交媒體：不得在社交平台、通訊軟體或公開場合討論公司機密資訊。

●舉報機制：若發現機密外流或可疑行為，請立即向主管或相關部門舉報。

(5) 違反後果

●內部處分：違反保密規定者，將送公司行政單位進行懲處，情節嚴重者可能終止勞動契約。

●法律責任：若洩密行為觸犯法律，公司將依法追究責任，絕不寬貸。

6. AI 工具使用規範

(1) 禁止輸入公司營運相關資料

使用 AI 工具時，嚴禁輸入任何與公司營運相關的機密資訊，包括但不限於：

●財務數據

●客戶資料

●產品開發計劃

●供應鏈資訊

●內部會議記錄

●未公開的專案內容

(2) 禁止輸入個人資訊

為保護個人隱私，請勿在 AI 工具中輸入任何個人資訊，包括：

●員工姓名、職位、聯絡方式

●身份證號、銀行帳戶等敏感資料

●其他可識別個人身份的資訊

(3) 避免使用公司帳號登錄外部 AI 平台

請勿使用公司電子郵件或內部帳號註冊或登錄外部 AI 平台。

(4) 違規處理

若發現違反上述規範之行為，將依公司資訊安全政策進行處理，情節嚴重者將追究相關責任。

7. 人力與資金投入

(1) 人力投入

●資訊安全管理委員會由各部門資安代表組成，共約 20 人，每月定期召開會議，討論資訊安全相關議題並推動執行。

●資訊安全專責部門或人員負責日常資訊安全管理工作，包括安全設備維護、事件應變、教育訓練等。

(2) 資金投入

●每年投入超過 500 萬元用於資訊安全相關設備和服務，包括：

◦防毒軟體

◦弱點掃描工具

◦防駭預警設備

◦Web 應用程式防火牆(WAF)

◦入侵防禦系統(IPS)

◦資料備份系統

8. 持續改進

●定期審查和評估資訊安全管理體系的有效性。

●關注最新的資訊安全技術和趨勢，及時更新管理措施。

●積極參與資訊安全交流和合作，提升資訊安全管理水平。

(四) 113 年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：無。

七、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
加工契約	客戶	一年	各型積體電路之封裝加工及測試承纜	保密責任
授權合約	Tessera	91.06 起	特定半導體整合迴路封裝技術	無
長期借款契約	中國信託主辦 共 12 家銀行參貸	113.04~118.04	聯貸	財務比率限制

伍、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年	112 年	差異	
			增(減)金額	變動比例%
流動資產	6,218,361	5,910,245	308,116	5.21%
不動產、廠房及設備	6,455,590	7,860,826	(1,405,236)	-17.88%
預付租賃款	0	0	0	0.00%
其他非流動資產	3,500,252	3,533,289	(33,037)	-0.94%
資產總額	16,174,203	17,304,360	(1,130,157)	-6.53%
流動負債	3,370,891	3,608,250	(237,359)	-6.58%
非流動負債	2,242,092	3,069,785	(827,693)	-26.96%
負債總額	5,612,983	6,678,035	(1,065,052)	-15.95%
股　　本	5,177,399	5,177,399	0	0.00%
資本公積	461,461	378,390	83,071	21.95%
保留盈餘	4,136,547	4,104,280	32,267	0.79%
其他權益	858,903	899,269	(40,366)	-4.49%
庫藏股	(207,468)	(25,270)	(182,198)	721.01%
權益總額	10,561,220	10,626,325	(65,105)	-0.61%

增減比例超過 20%之主要原因說明如下:

1.其他非流動負債減少，主係 113 年度借款減少及認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益所致。

2.資本公積增加，主係 113 年度認列子公司對股權回購義務變動產生之權益變動數沖銷其他權益之差額所致。

3.庫藏股增加，主係 113 年度買回公司股份所致。

二、財務績效：

(一) 財務績效分析比較：

單位：新台幣仟元

項目 \ 年度	113 年	112 年	差異	
			增(減)金額	變動比例%
營業收入淨額	7,859,456	7,276,069	583,387	8.02%
營業成本	7,361,293	7,144,004	217,289	3.04%
營業毛利	498,163	132,065	366,098	277.21%
營業費用	418,903	386,796	32,107	8.30%
營業利益	79,260	(254,731)	333,991	-131.12%
營業外收入及支出	(37,024)	104,526	(141,550)	-135.42%
稅前淨利	42,236	(150,205)	192,441	-128.12%
所得稅費用	70,050	(37,553)	107,603	-286.54%
本年度其他綜合損益	(360,374)	601,516	(961,890)	-159.91%
本年度綜合損益總額	(388,188)	488,864	(877,052)	-179.41%

變動項目說明：

1.營業毛利、營業利益、稅前淨利、所得稅費用增加，主係 113 年度營業收入增加所致。

2.營業外收入及支出減少，主係 113 年度透過損益按公允價值衡量之金融資產利益減少所致。

3.其他綜合損益、綜合損益總額減少，主係認列透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資未實現評價損益所致。

(二) 預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：

本公司依據以往年度銷售經驗及未來接單狀況，預計 114 年度業務將較 113 年度些微成長。為達此一銷售目標，本公司將提高生產力，提昇客戶服務滿意度，並增加新客源以達到銷售目標。

三、現金流量

(一) 最近年度流動性分析

項目 \ 年度	113 年度	112 年度	增減比例(%)
現金流量比率（%）	62.76	72.64	-13.6%
現金流量允當比率（%）	107.46	92.56	16.1%
現金再投資比率（%）	3.94	4.85	-18.8%
說明：無。			

(二) 流動性不足之改善計畫：不適用。

(三) 未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額 ①	預計全年來自營業活動淨現金流量 ②	預計全年現金流出量 ③	預計現金剩餘(不足)數額 ①＋②－③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	融資計畫
2,516,207	1,863,000	1,897,000	2,482,207	0	0

1.現金流量變動情形分析

(1)營業活動淨現金流入：主係來自純益及折舊費用。

(2)投資活動淨現金流出：主係購置不動產、廠房及設備。

(3)融資活動淨現金流出：主係償還銀行借款。

2.預計現金不足之補救措施：不適用。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一) 重大資本支出之運用情形及資金來源單位：　　單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	預期完工日期	所需資金總額	實際或預計資金運用進度		
				一一三年度	一一四年度	一一五年度
購置機器設備	自有資金、銀行貸款	115.3.31	740,000	0	592,000	148,000

(二) 對財務業務之影響：

新增之機器設備可擴充生產產能，增加公司銷售額，提昇公司獲利能力。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計劃及未來一年投資計劃：

(一) 轉投資政策：

本公司為專業之記憶體封裝測試廠，為因應產業未來發展趨勢及整合封測核心事業及提升產品競爭優勢，發展封裝及測試事業。

(二) 主要轉投資獲利或虧損之主要原因、改善計劃：

轉投資事業	獲利(虧損)之主要原因	改善計畫
華東科技(蘇州)有限公司	本年度虧損係未達到經濟規模所致。	提升效率及降低成本以期損益兩平。
鑫豐科技有限公司	本年度虧損係未達到經濟規模所致。	提升效率及降低成本以期損益兩平。
華昕科技(蘇州)有限公司	本年度獲利，主係達到產品已達經濟規模所致。	提升效率及降低成本以持續達成獲利。

(三) 未來一年轉投資計畫：

本公司將視接單生產狀況，斟酌投資金額。

六、風險事項：

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

1.利率：本公司 113 年度利息支出為 153,340 仟元，占當年度營收淨額之比率為 1.95%，因屬資本密集產業、須不斷挹注資金投資設備，強化競爭力，本公司與往來銀行長期保持良好之合作關係，故能取得有利之資金成本。

2.匯率：本公司 113 年度兌換利益為 214,957 仟元，占當年度營收淨額之比率為 2.74%，本公司為降低匯兌風險，與往來銀行的外匯部門保持密切聯繫，以掌握匯率變動的走勢，做為結匯之參考依據。

3.通貨膨脹情形：本公司 113 年生產原料及產品售價係依合約訂價，通膨對本公司營運較無重大影響。

(二) 最近年度及截至年報刊印日止，從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.本公司已訂定「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」，並經股東會決議通過。

2.目前本公司並無從事高風險、高槓桿投資之情形，故對本公司並無重大風險影響。

3.本公司從事資金貸與他人、背書保證時，除遵照「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」外，並依據主管機關及本公司相關規定辦理，定期稽核並依法公告申報。

4.本公司有關衍生性商品交易之執行與否，將視市場狀況而定。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：

未來之研發除持續配合輕、薄、短、小之產品趨勢發展外，將著重於封裝及測試之平台整合，並致力於 eMCP、eMMC、SIP、POP、FlipChip、Fan Out、ENIG、Coupler 等技術開發，以因應消費性及行動裝置產品效能與頻率之提昇。

未來一年預計投入研發費用約近新台幣 8 仟 5 佰萬元。

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司均依循國內外相關法令規範辦理外，並隨時注意所處產業之國內外政策發展趨勢及法規變動情形，故最近年度國內外重要政策及法律變動並未對本公司財務業務產生影響。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

本公司隨時留意半導體產業之技術發展，及客戶之產品趨勢走向，以隨時與客戶產品接軌。並評估未來發展，研發各種封裝測試技術及新設備之投資，以符合市場需求，故科技改變及產業變化對公司財務業務，並無重大影響。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司並無企業形象改變，造成對企業危機管理之情事。

(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無進行併購之計劃。

(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

截至年報刊印日止，本公司無擴充廠房之計劃。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

進貨方面：本公司主要從事 IC 記憶體之封裝及測試，原料需求主要為導線架、基板、金線、環氧樹脂、膠膜及銀膠等原物料，均各有二家以上之供應商來源，尚無進貨集中之情形。

銷貨方面：因記憶體晶圓製造廠之集中度較高，致下游封測之客戶群選擇組合較少。為降低此風險，除與原有客戶建立良好之策略聯盟關係外，並積極開發新客戶，以降低銷貨集中之風險。

(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：

截至年報刊印日止，並未有經營權改變之情事。

(十二)訴訟或非訟事件：

1.本公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

2.公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

陸、特別記載事項

一、關係企業相關資料：

(一) 關係企業合併營業報告書：

相關資訊請至公開資訊觀測站（網址：https:/mops.twse.com.tw），單一公司處點選電子文件下載「關係企業三書表專區」登詢。

(二) 關係企業合併財務報表：無。

(三) 關係報告書：無。

二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、其他必要補充說明事項：

與財務資訊透明有關人員取得相關證照情形：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所訂，對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

華東科技股份有限公司
內部控制制度聲明書

日期：一一四年二月二十日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國一一四年二月二十日董事會通過，出席董事九人中，有零人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

華東科技股份有限公司

董事長：焦佑衡

總經理：于鴻祺

華東科技股份有限公司

負責人：焦佑衡